

Korszerű számítógép architektúrák II.

Készítette: Simon Péter¹

2021. december 14.

¹Hallgatói jegyzet Sima Dezső előadásai alapján

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	5
1.1. A tárgy célja	5
1.2. Csíkszélesség	5
1.3. Pentium 4 processzorcsalád	5
1.4. Intel Core processzorok fejlesztése	5
1.5. Gyártási technológia	6
1.6. Utasításkészlet fejlődése	6
1.7. A mikroarchitektúra fontosabb újításai	6
1.8. Fejlődés IPC-ben kifejezve	7
1.9. Frekvencia vs tranzisztorok száma	7
2. Intel Core 2 család	9
2.1. Kategorizálás	9
2.2. Kliens processzorok fejlődése	9
2.2.1. Magok száma	9
2.2.2. Memória csatornák	9
2.2.3. Memória vezérlő elhelyezése	10
2.2.4. Memória sebessége	10
2.2.5. Grafika	10
3. HEDT processzorok fejlődése	12
3.1. Bevezetés	12
3.2. PCIe vonalak	12
3.3. Magszámok	12
3.4. Memóriacsatornák	13

3.5. Overclocking	13
3.6. Fogyasztás	13
3.7. Grafika	13
4. Nagy teljesítményű, két foglalatos szerver processzorok fejlődése	14
4.1. Szerver platformok osztályozása	14
4.2. Méret, tranzisztorok	14
4.3. Fogyasztás	14
4.4. Lábak száma	14
4.5. Magok száma	15
4.6. Intel Cascade Lake 9200-AP	15
4.7. Magszámok és tranzisztorok növekedése	15
4.7.1. Kivételek	16
4.8. Memória sebességek fejlődése	16
5. Mobil és táblagép processzorok fejlődése	18
5.1. Bevezetés	18
5.2. Fogyasztás csökkentése	18
5.2.1. Intel Atom	18
5.2.2. AMD	18
5.2.3. A frekvencia csökkentése	19
5.3. Piaci részesedés	19
5.4. Szélesség fejlődése	21
6. Disszipációkezelés	22
6.1. A disszipációkezelés fontossága	22
6.2. A disszipáció	22
6.2.1. Kiszámítása	22
6.3. TDP	23
6.4. Intel processzorok disszipációjá a fejlődés során	23
6.5. Disszipációcsökkentő kezdeményezések	24
6.5.1. Energy Star	24
6.5.2. Az AMD hatékonysági kezdeményezése	25

6.5.3. Szerverek energiahatékonysága	25
6.6. ACPI	25
6.7. A disszipációkezelés technikái	26
6.7.1. Kezelés áramköri szinten	26
6.7.2. Kezelés platform szinten	27
6.7.3. Kezelés CPU szinten	27
6.8. Az Intel Turbo Boost techológiája	32
6.8.1. Bevezetés	32
6.8.2. Első generáció	32
7. Az AMD Zen processzorai	34
7.1. Bevezetés	34
7.2. Áttekintés	34
7.3. A Zen család tervezési elvei	35
7.3.1. Többlapkás felépítés	35
7.3.2. Moduláris kialakítás	36
7.3.3. A CPU-k és GPU-k három szintű hierarchikus tervezése	36
7.4. A Zen magok fejlődése	38
7.5. A CCX-ek fejlődése	39
7.6. A grafikai magok fejlődése	40
7.6.1. A Vega CU felépítése	41
7.7. A Zen processzorok építőelemei és felépítése	41
7.7.1. Első generáció	41
7.7.2. Második generáció	42
7.7.3. Harmadik generáció	42
7.8. Infinity Fabric	43
7.8.1. Scalable Control Fabric	43
7.8.2. Scalable Data Fabric	43
7.8.3. Példa: első generációs, GPU nélküli desktop Zen CPU	44
7.8.4. Példa: első generációs EPYC szerver CPU	44
7.8.5. Példa: első generációs 2S EPYC szerver CPU	46
7.8.6. Második generációs IF	46

7.9. MCM tokozás	46
7.10. A Zen processzorcsalád tagjai	47
7.11. Példa: Zen 3 alapú, GPU nélküli Ryzen 5000	47

1. fejezet

Bevezetés

1.1. A tárgy célja

A tárgy célja ismertetni a jelenleg domináns architektúrákat (Intel Core, AMD Zen, ARM), speciális témaköröket (pl. disszipáció) és a mobil architektúrákat.

1.2. Csíkszélesség

A processzor csíkszélessége a hagyományos (planár) MOSFET tranzisztorokat használó processzoroknál a tranzisztor kapu szélességét jelenti. Az Intel által bevezetett 3D FinFET tranzisztorok jellemzéséhez már több paraméterre lenne szükség, de a publikációkban továbbra is egy számot használtak. Ezért gyártónként eltérően kell értelmezni a gyártástechnológiát. Pl. az Intel 10 nm technológiája nagyjából a Samsung vagy a TSMC 7 nm-esének felel meg.

1.3. Pentium 4 processzorcsalád

A Core 2 család előzte a Pentium 4 processzorcsaládot, ami valójában 3 generációt jelent (Willamette, Northwood, Prescott). A Pentium 4 fontos innovációkat tartalmazott, alapja a Netburst mikroarchitektúra. Második generációja hozta be először a többszálás architektúrát, a harmadik pedig a 64 bites architektúrát és a több processzormagot (Pentium D).

2000-ben 7 éves élettartamot vártak a Netburst-től, de 2004 körül a bejelentett architektúrákat visszavonták, mivel a várt 10 GHz-es frekvencia helyett csak 3.6-at értek el, a disszipáció miatt. A Prescott processzorok 1 cm²-en 100 W-ot adtak le, amivel elérte a léghűtéses rendszerek határát.

1.4. Intel Core processzorok fejlesztése

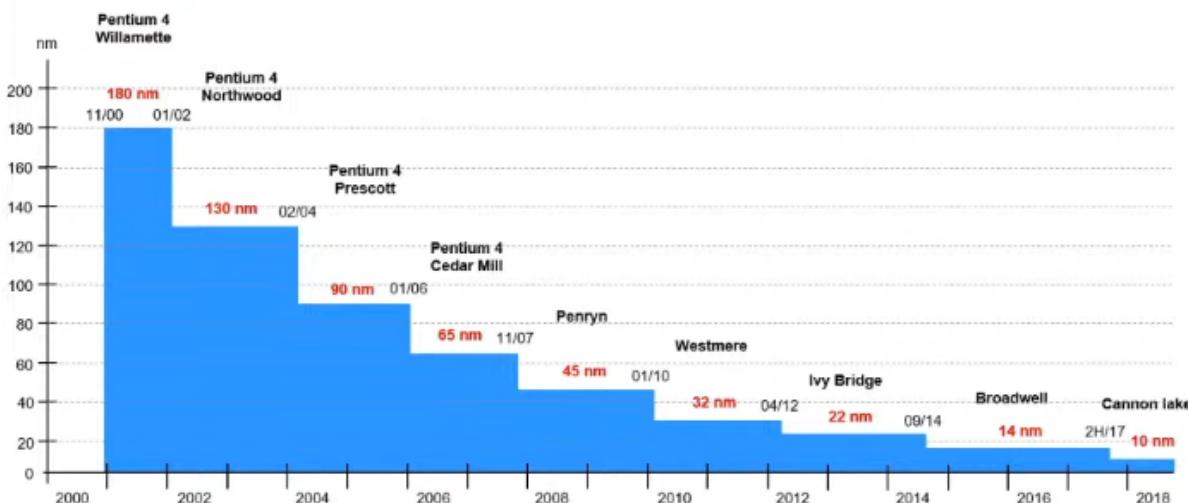
A fejlesztők ezentúl másik irányban folytatták a tervezést, a nyers teljesítmény növelése helyett az 1 W-ból kihozható teljesítmény maximalizálására törekedtek. 2006 környékén a mobil processzorok megjelenésével egy újabb tervezési irány jelent meg: a minél alacsonyabb fogyasztás, a jobb üzemi idő elérése miatt.

A célok elérése érdekében a Pentium 4-ig használt egyfázisú fejlesztési modellt két fázisúra (Tick-Tock)

cserélték. Az első fázisban döntően a csíkszélesség csökkentésére fókusztáltak, a másodikban pedig a mikroarchitektúrát fejlesztették. Ez a fejlesztési modell a Core 2 processzorcsaládtól kezdődött, és a Skylake-ig tartott, amit viszont nem követett csíkszélesség csökkentés, így a fejlesztés visszaállt egy fázisúra.

1.5. Gyártási technológia

A gyártástechnológia fejlődése a 1.1. ábrán látható. Látható, hogy 22-14 nm környékén lelassult a fejlődés.



1.1. ábra. Intel processzorok csíkszélessége

Az Intel ennek ellenére 2019-ben két évenkénti csíkszélesség csökkentést jósolt 2029-ig.

1.6. Utasításkészlet fejlődése

Az utasításkészlet legfontosabb fejlesztése a vektorfeldolgozás volt, először 64 biten, majd a későbbiekben 128, 256 és újabban 512 bitre szélesítették.

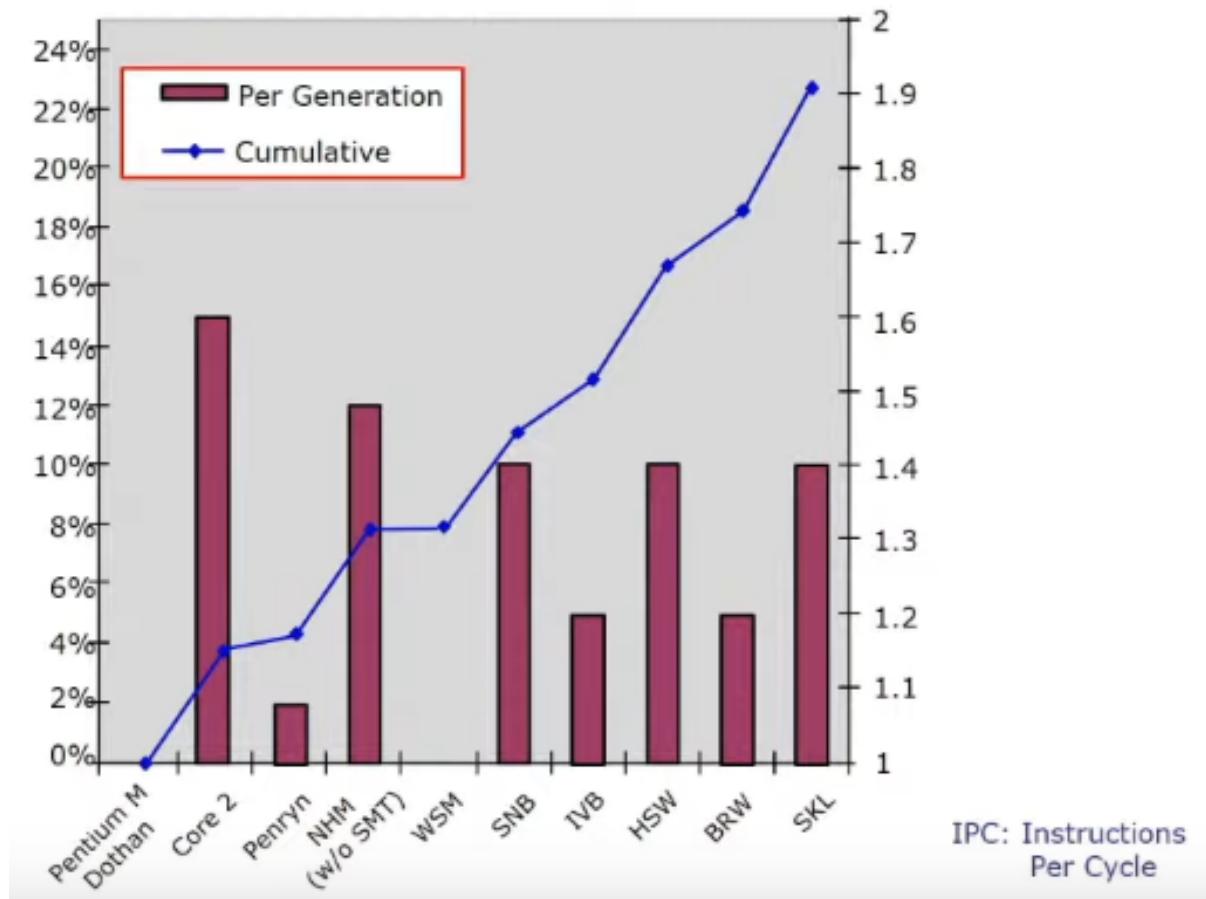
1.7. A mikroarchitektúra fontosabb újításai

A Core 2 processzorok 3 helyett 4 széles magokat használtak, kb. 30%-al nagyobb teljesítményt eredményezve. Ezzel lehagyta az AMD-t. A Nehalem architektúránál jelent meg az integrált memóriavezérlő és a 3. szintű cache, valamint újra a többszálú végrehajtás. A Sandy Bridge legfőbb újdonsága a lapkára integrált videokártya volt. A Skylake 5 széles magokat alkalmazott és megjelentek az egy tokba integrált CPU, GPU és nagy teljesítményű memória lapkák. 2017-ben az AMD konkurenciájára válaszul az Intel növelte a magok számát 6-ra, 8-ra, majd 10-re.

Egy másik fontos fejlődési irány a disszipáció kezelése volt, erről később részletesebben.

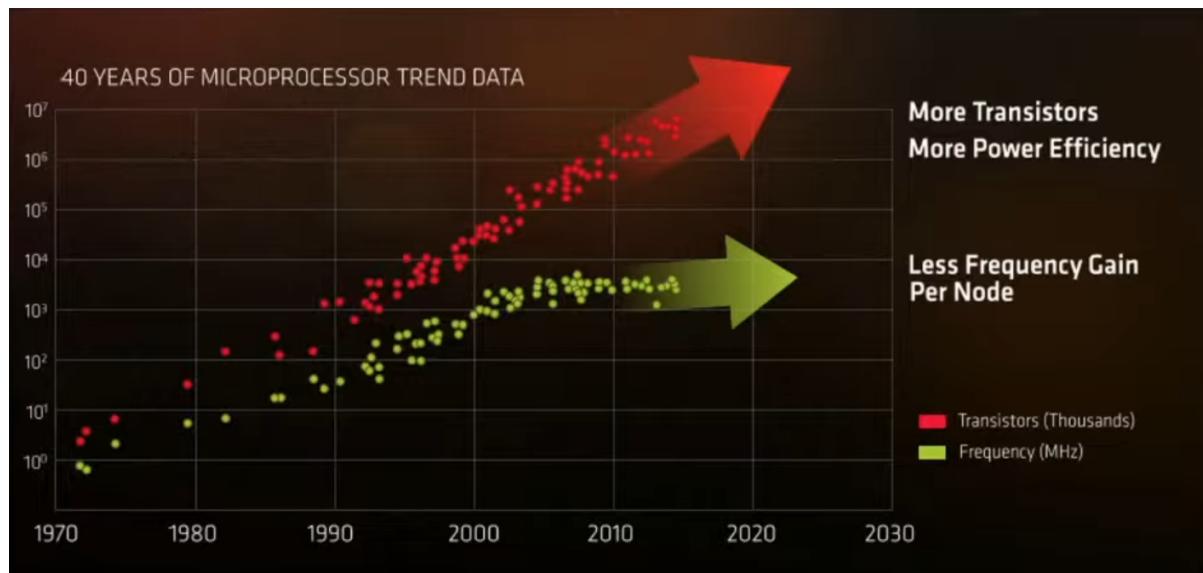
1.8. Fejlődés IPC-ben kifejezve

Az ábrán látható, hogy az architekturális váltást hozó processzorok jóval nagyobb (kb. 10%) teljesítmény növekedést hoztak, mint a technológiai váltást hozók.



1.9. Frekvencia vs tranzisztorok száma

A következő ábra jól mutatja, hogy az utóbbi kb. 20 évben megállt a frekvencia növekedése, a fejlődés fő iránya a tranzisztorok számának növelése és az energiahatékonyság.



2. fejezet

Intel Core 2 család

2.1. Kategorizálás

A Core 2 családot 4 csoportra oszthatjuk:

- szerverek (e3, e5, e7, Platinum, Gold)
- high-end desktopok (i7, i9)
- desktopok, laptopok (i3, i5, i7), összefoglalva kliensek
- mobilok (Atom - 2016-ban visszavonva)

A magok száma kategóriánként változik: szerverek max. 28, HEDT max. 18, desktopok 2-10 + grafika, mobilok max. 10 + grafika. A magok számával a lapkaméret is nő, a szerverek nagyobbak a klienseknél és a mobiloknál.

2.2. Kliens processzorok fejlődése

2.2.1. Magok száma

A többmagos fejlődést a Pentium D indította el, de ez még nem valódi kétmagos processzor volt, mivel két, egymagos lapkát tokoztak egybe. Ezután a Core 2 valósított meg 2 magot egy lapkán. A Core 2 Quad 2 db 2 magos lapkát tokozott egybe. A Nehalemmel már egy lapkán 4 mag lehetett.

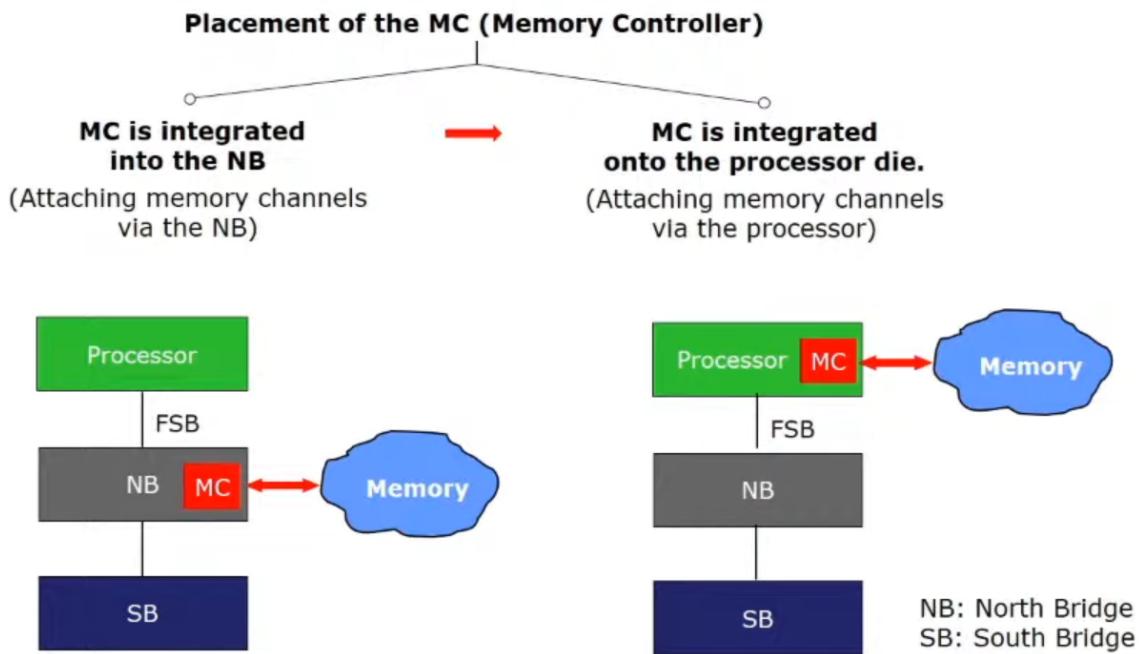
Később megjelent a grafika, egy harmadik, egybetokozott grafikai maggal. Ezután sokáig nem történt semmi, a magok száma maximum 4 maradt. 2017-ben, hogy konkurenciát nyújtsanak az AMD-nek, emelték a magok számát. A 10 nm-es rendszerek megjelenésekor az Intel nem követte a magszám növekedés irányát, először 2, aztán 4 magot alkalmazott.

2.2.2. Memória csatornák

A memória csatorna szám végig 2 maradt. Bár a magok számának növekedésével gyorsabb memória hozzáférésre is szükség volt, a memóriák fejlődése ellensúlyozta azt, hogy nem lett több csatorna.

2.2.3. Memória vezérlő elhelyezése

A Nehalem előtt a memóriavezérlőt az északi hídra helyezték. Hátránya, hogy az északi híd és a processzor közötti kapcsolatot tereli a memória forgalma. Ez főleg több processzoros rendszerekben negatívum, mivel az északi híd ekkor komolyan korlátozza a memória sávszélességét. Tehát a processzorszám növekedésével a memória nem skálázódik. Ezért a Nehalem-től a memória közvetlenül a processzorhoz csatlakozik (a lapkán lévő vezérlőhöz), ami rövidebb utakat és tehermentesített északi hidat jelent (2.1. ábra). Előny, hogy processzorunként külön memória kapcsolat létezhet, azaz skálázódik a processzorszámmal.



2.1. ábra. Memória kontrollek elhelyezkedése

Később az északi híd egybeolvadt a délivel, amit periféria vezérlőnek neveztek el.

2.2.4. Memória sebessége

A DDR (Double Data Rate) memóriák átviteli sebessége kétszerese az órajelének, tehát a DDR4-2400 (MT/s) átviteli sebességű memória frekvenciája 1200 MHz. Az átviteli sebesség jelentősen fejlődött, 10 év alatt megháromszorozódott.

2.2.5. Grafika

A grafikai magok generációjának számozása 5-től kezdődik a Westmere-nél, mivel előtte is volt grafika, csak az északi híd látta el a feladatát. Westmere-nél még csak egybe volt tokozva, de Sandy Bridge-tól már egy lapka.

A grafikai technológiai szint jelölésénél a GR2 egy grafikai szeletet tartalmaz, a GT3 kettőt, a GT4 pedig hármat. A GT1 rész szeletet jelöl (kevesebb végrehajtó egység mint a többiben).

A végrehajtó egységek száma 6-ról 96-ra nőtt az évek során.

A Westmere és a Sandy Bridge még nem támogatott OpenCL-t, de Ivy Bridge már igen.

A teljesítmény növekedése a Sandy Bridge-től Skylake-ig kb 7x-es.

A Haswell grafikai végrehajtó egysége

Egy szelet 20 végrehajtó egységet tartalmaz, két fél szeletre osztva. A két fél szelet egy közös adat cache-en dolgozik és egy buszrendszeren kapcsolódik. Egy végrehajtó egység (EU) négy funkcionális egységet tartalmaz:

- Send - adat küldés/fogadás
- Branch - elágazáskezelés
- 2x SIMD (Single instruction multiple data) feldolgozó

Minden SIMD egység négy darab egyszeres pontosságú adaton tud MAD (Multiply-Add) műveleteket végrehajtani. Tehát minden EU $2 \times 4 \times 2 = 16$ utasítást tud ciklusonként elvégezni. Az EU 7 szálon többszálú, minden szálnak 128 db 32 bites regisztere van. Ezen kívül képes lebegőpontos és transzcendens matematikai műveletek végrehajtására.

A Haswell grafikai újdonsága, hogy kapott egy kiegészítő eDRAM-ot is, ezeket az egységeket neveztek Iris Pro-nak.

3. fejezet

HEDT processzorok fejlődése

3.1. Bevezetés

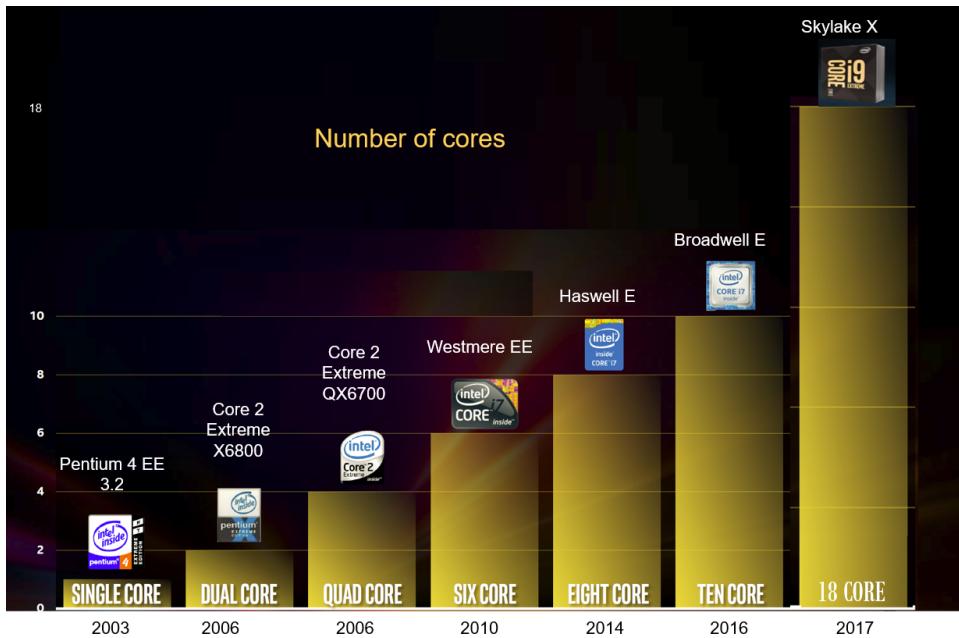
A HEDT (High-End Desktop) processzorok a nagyteljesítményű asztali gépek processzorait jelentik. Ilyenek az Intel i7 és i9 Extreme Edition modellek. Döntően a játékosok és tartalom kreatörök igényeit igyekeznek kiszolgálni. Ezeknek a felhasználóknak nagy teljesítményre és jó minőségű grafikára van szükségük, ezért az ilyen processzoroknak több, akár 4 grafikus kártyát is támogatniuk kell.

3.2. PCIe vonalak

Ehhez több PCIe vonalra van szükség (kártyánként 8 vagy 16). A Core 2 Extreme (2006 körül) család (4x8) 32 PCIe vonalpárt tartalmazott, amik az északi hídra csatlakoztak. Ez csak a Sandy Bridge-el változott meg, ahol már a lapkára csatlakoztak. Az Ivy Bridge előtt a PCIe 2.0 változatát támogatták a processzorok, Ivy Bridge-től pedig 3.0-t.

3.3. Magszámok

Mivel ezek a feladatok (pixelek feldolgozása) jól párhuzamosíthatók, több mag és így több memória csatorna van a HEDT processzorokban. A magoknak csak a technológiai korlátok szabtak határt. Kezdetben (Core 2 Extreme) ez 2 magot jelentett, majd fokozatosan 18 magra nőtt.



3.1. ábra. Intel HEDT processzorok magszámának fejlődése

3.4. Memóriacsatornák

A kezdetekben a viszonylag kevés mag könnyen kiszolgálható volt 2 memóriacsatornával, de ahogy növekedtek a magok számai, úgy nőtt a memóriacsatornák száma is, először 3-ra, majd 4-re.

3.5. Overclocking

A processzorok órajelét egy szorzó állítja elő, ami megszorozza a buszfrekvenciát (100/133 MHz) egy olyan faktorral, amit a Power Control Unit ad (pl. 20). A HEDT processzorok szorzója nem rögzített, tehát a hozzáértő felhasználók növelni tudják a processzor sebességét, nagyobb disszipáció árán.

3.6. Fogyasztás

A HEDT processzorok nagy fogyasztással rendelkeznek a sok mag és memóriacsatorna miatt (130-160 W). A processzorok teljesítményét TDP-ben szokás megadni (Thermal Design Power). A hűtési rendszert erre az értékre kell tervezni.

3.7. Grafika

A HEDT processzorok nem tartalmaznak integrált grafikát, mivel az ilyen PC-kben jellemzően nagy teljesítményű, diszkrét grafikus kártyák dolgoznak.

4. fejezet

Nagy teljesítményű, két foglalatos szerver processzorok fejlődése

4.1. Szerver platformok osztályozása

A szerver rendszerek feloszthatók egy processzoros (UP) és több processzoros platformokra. A több processzoros platformok feloszthatók két foglalatos (2S/DP), négy vagy nyolc foglalatos (4S, 8S) és nyolcnál több foglalatos rendszerekre. A piac nagy részét a két processzoros szerverek teszik ki (kb. 80%), ezért részletesebben ezekkel foglalkozunk.

4.2. Méret, tranzisztorok

A 2S szerver processzorok nagy méretűek, sok tranzisztort tartalmaznak. A 2000-es évek közepén a Pentium 4 szerver processzorok még viszonylag kevés tranzisztorból álltak (125 millió), ezért elég volt kb 1 cm²-es lapka. A magok számának növekedésével egyre több tranzisztor kellett, a Skylake (2017) processzoroknál már 8 milliárd. Még újabb CPU-knál nincs információ. Ezzel együtt a lapkaméret is tovább nőtt, a mai lapkáknál 8 cm² körüli.

Mivel a lapkák gyártása nagyon komplex, nagyobb méretű lapkáknál több hiba előfordulhat, ezért alacsonyabb lesz a kihozatali arány. A lapkák méretét így a gazdasági hatékonyság is meghatározza.

4.3. Fogyasztás

A HEDT processzoroknál is nagyobb fogyasztással kell számolni a szerver processzoroknál, 130-tól 200 W felettig mennek.

4.4. Lábak száma

A szerver processzorok sok lábbal kapcsolódnak a foglalatokhoz, amik precíz gyártást igényelnek.

4.5. Magok száma

A szerver alkalmazások általában jól párhuzamosíthatók, így a processzorok a lehető legtöbb magot implementálják. A Pentium 4 szerver processzoránál még csak 1 mag volt, de később 28-ig növekedett a magok száma.

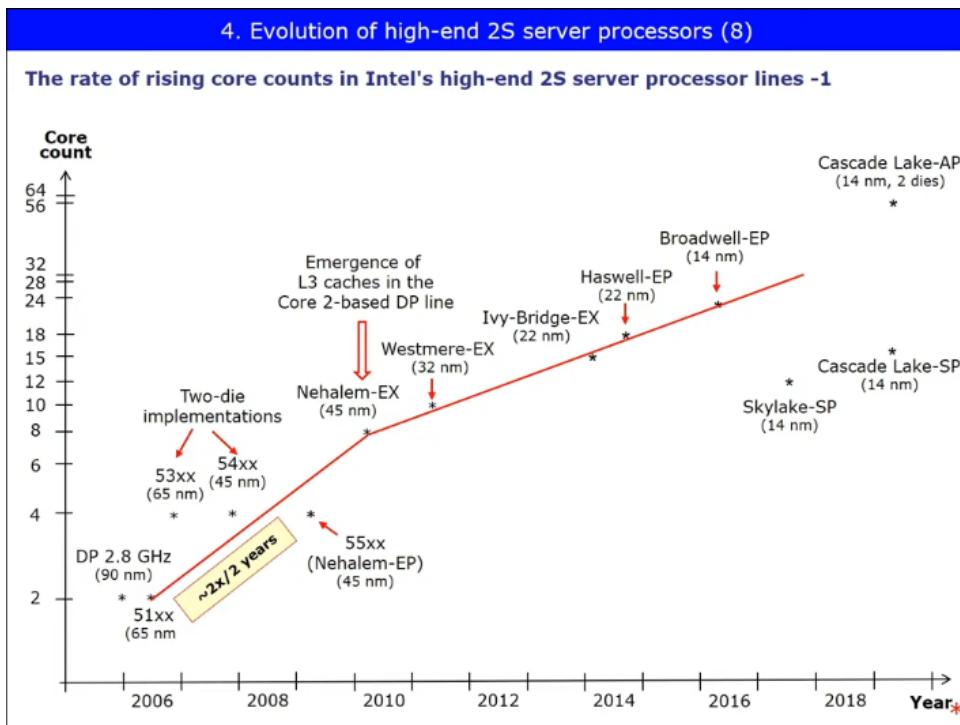
4.6. Intel Cascade Lake 9200-AP

Ez a 2x28, azaz 56 magos processzor az Intel válasza volt az AMD 64 magos EPYC Rome processzoraira. Az AMD 2017-ben adta ki ezt a processzort, ami valós konkurenciát állított az Intelnek, ami 2015 környékén még nagyrészt egyeduralkodó volt a szervereknél. Ezért az Intel két 28 magos lapkát tett egy foglalatba, és BGA (Ball Grid Array) tokozással látta el, ami forrasztásra készült. A forrasztás miatt nem voltak külön megvásárolhatók, csak OEM-ek kapták meg.

A két lapka egybecsomagolása miatt egy két foglalatos rendszer gyakorlatilag 4 processzort jelent.

4.7. Magszámok és tranzisztorok növekedése

A kétfoglalatos szerver CPU-k esetében kb 2 évente duplázdódt a magok száma (4.1. ábra).

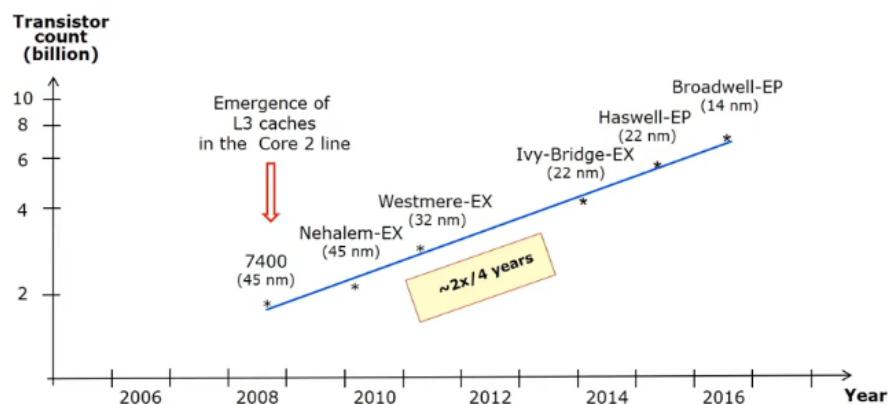


4.1. ábra. Intel 2S szerver processzorok magszámának fejlődése

Ez összhangban van a Moore-szabálytal, ami szerint a tranzisztorok száma két évente duplázdik. Az utóbbi években viszont lelassult a fejlődés, már csak négy évente duplázdódt a magok száma. Ennek egyik oka az L3 cache megjelenése, ami elfoglalja a lapka jelentős részét, mivel nagyon sok tranzisztor kell a működéshez. A technológi változása miatt a Moore törvénnyel ellentében az Intel már csak 4 évente tudta dupláznai a tranzisztorok számát (4.2. ábra). Ennek az oka, hogy a sok tranzisztor disszipációját kezelní kell, ami korlátozza a fejlődést.

4. Evolution of high-end 2S server processors (10)

Evolution of transistor counts of Intel's Core 2 based HE server processor dies



As the above Figure shows, transistor counts rise slower than would be according to Moore's law. This can presumably be attributed to heat issues caused by the limited power budget.

*

4.2. ábra. Intel 2S szerver processzorok tranzisztorszámának fejlődése

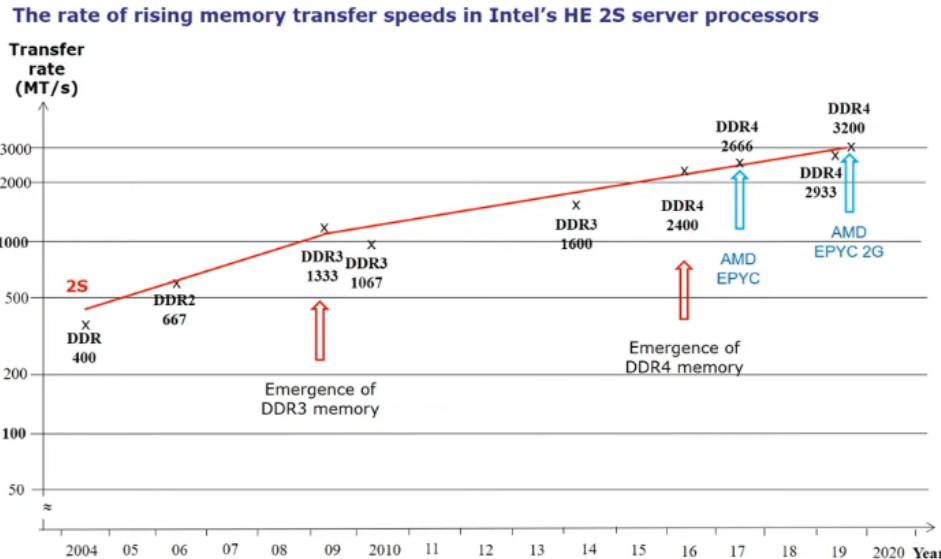
4.7.1. Kivételek

Néhány processzor az ábrán nem illik a fejlődési görbüre, ezek az AMD konkurenciára adott válaszoknak köszönhetők.

4.8. Memória sebességek fejlődése

A memória sebességeknél adatátviteli rátával jellemzők őket, mivel a frekvencia nem azonos az átviteli sebességgel a DDR (Double Data Rate) memóriák esetében.

4. Evolution of high-end 2S server processors (11)



*

4.3. ábra. Memória sebességek fejlődése

A ???. ábrán látható, hogy a DDR és DDR2-es memóriák gyorsabban fejlődtek, mint a DDR3 és DDR4 memóriák. Az első szakaszban egy duplázódáshoz 4 év kellett, DDR3 óta pedig már 8. Ennek oka a DDR3-as memóriák jóval komplexebb felépítése, ami lassította a fejlődést. A magok száma tehát gyorsabban növekedett, mint a memóriák sebessége, ami konfliktusforrás.

Szerverek esetében elvárás, hogy az egymástól függetlenül működő magokat azonos memória sávszélességgel kell ellátni. Tehát a sávszélességet lineárisan skálázni kell a magszámmal együtt. A foglalatonkénti sávszélesség kiszámítása:

$$BW/core = n_M * w * T_M/n_C \quad (4.1)$$

ahol:

- n_M : memória csatornák száma
- w : memória csatorna szélessége (pl. 8 byte)
- T_M : memória átviteli rátája (pl. 2.4 GT/s)
- n_C : magok száma

Probléma, hogy a transzfer ráta lassabban nő, mint a magok száma, tehát T_m/n_C folyamatosan csökken. Megoldás a memória csatornák számának növelése. Ez azonban elég komplex feladat.

A magonkénti memória sávszélességnél referenciának tekinthető a Pentium 4 DP rendszer, a fejlesztési cél ehhez az értékhez tartani.

5. fejezet

Mobil és táblagép processzorok fejlődése

5.1. Bevezetés

Az okostelefonok 2006 körül jelentek meg, a táblagépek ennél is később, 2010-ben. A fő prioritás az üzemidő, tehát alacsony fogyasztású processzorokat kell fejleszteni. Ez ellentétes az addig uralkodó fejlesztési iránytól (legnagyobb teljesítmény wattoinként).

5.2. Fogyasztás csökkentése

Az alacsony fogyasztást kétféleképpen lehet elérni:

- keskeny mikroarchitektúrákkal
- alacsony órafrekvenciával.

Az ARM Cortex család korai tagjai ezt általában 2 (3 a Cortex A15 esetében) széles architektúrával (egyszerre 2 utasítás vágrehajtására képes) érték el.

5.2.1. Intel Atom

Az Intel viszont a Core 2 családtól kezdve 4 szélességű architektúrát implementált, a nagyobb teljesítmény/fogyasztás arány elérése érdekében. Következmény, hogy az Intel és AMD hagyományos mikroarchitektúrái nem voltak versenyképesek az ARM-el szemben. Ezért kifejlesztettek egy új mikroarchitektúrát, ami 2 szélességű. Így jött létre 2008-ban az Intel Atom családja, amire alapozva megjelentek az Intel okostelefon platformjai.

5.2.2. AMD

2011 környékén az AMD a Bulldozer mikroarchitektúrára épülő processzorokat gyártotta, ami végül nem vált be. Ezzel párhuzamosan bevezették a kisebb fogyasztású Cat mikroarchitektúrát, az Atomhoz hasonlóan 2 szélességgel. Ez is a mobil piacot célozta.

5.2.3. A frekvencia csökkentése

A disszipáció két részből áll: statikus és dinamikus. Statikus a zárt tranzisztorokban szivárgó áram által kellett disszipáció, dinamikus pedig a működő tranzisztorok által kellett. Következmény, hogy a dinamikus disszipáció egyenesen arányos az órafrekvenciával, mivel magasabb frekvencián több töltéskisülés keletkezik. Ezen kívül négyzetesen arányos a magfeszültséggel (Ohm-törvény). Tehát a dinamikus disszipáció:

$$D_d = \text{const} * f_c * V^2 \quad (5.1)$$

Mivel a frekvenciához arányosan nagyobb feszültség kell, ezért a disszipáció a frekvencia növelésével köbönként növekszik. Ezt mutatja a 5.1. ábra.

TDP (W)	No. of cores	Graphics	No. of graphics EU	eDRAM	Base frequency (GHz)
4.5	2	HD 515	18	--	1.2
15	2	HD 540	48	64 MB	2.2
15	2	HD 520	24	--	2.6
28	2	HD 550	48	64 MB	3.3
35	4	HD 530	24	--	2.8
45	4	HD 530	24	--	2.9
65	4	HD 530	24	--	3.4
91	4	--	--	--	4.2

5.1. ábra. Az Intel Skylake család órajelei és fogyasztásai

A Skylake család gyengébb tagjait táblagépekbe szánták, ezeknél az alacsony fogyasztás érdekében gyengebb grafikát, kevesebb magot és alacsony órajelet használtak.

5.3. Piaci részesedés

A fejlesztések ellenére az Intelnek és AMD-nek nem sikerült betörniük a mobil eszközök piacára.

Smartphone application processors worldwide market share 2015 (revenue)	
Qualcomm (USA)	42 %
Apple (USA)	21 %
MediaTek (Taiwan)	19 %
Samsung (S. Korea)	
Spreadtrum (China)	

5.2. ábra. Az okostelefon processzorok piaci részesedése 2015-ben

Bár az Intel a táblagépeknél elért valamekkora részesedést, ezt úgy érte el, hogy fizetett a gyártóknak az Atom processzor használatáért.

Tablet application processors worldwide market share 2015 (revenue)	
Apple (USA)	31 %
Qualcomm (USA)	16 %
Intel (USA)	14 %
MediaTek (Taiwan)	
Samsung (S. Korea)	

5.3. ábra. A táblagép processzorok piaci részesedése 2015-ben

A gyártóknak fizetett összegek miatt az Intelnek 2 év alatt 7 milliárd dollár vesztesége keletkezett. A nagy veszteségek miatt 2016-ban az Intel visszavonult a mobil piacról, a már bejelentett rendszereket pedig törölték. Ezzel együtt 12000 embert bocsátottak el.

Az AMD 2015-ban még megjelentetett egy új mobil családot, de a 2016-os kínálatban már nem szerepeltek mobil processzorok. Helyette 2017-től a Zen architektúrát fejlesztették.

Az Nvidia szintén gyártott mobil processzorokat a 2010-es évek elején, de 2016-ban ők is kivonultak a

piacról.

5.4. Szélesség fejlődése

A keskeny szélesség és alacsony frekvencia követelmények a processzorok fejlődésével kevésbé lett k lényegesek, mivel nagyon sok fejlesztés történt a disszipáció csökkentésére. 2010 környékén még jellemzően 2 széles rendszerek voltak a mobilokban, aztán a teljesítmény növelése érdekében 3 szélesre növelte a processzorait az ARM, az Apple, a Qualcomm és a Samsung is. A fejlődés itt nem állt meg, az ARM 2018-ban 4 széles rendszereket hozott ki. Szintén 4 széles a Samsung M1 magja is. Ezután még 6, 7 és 8 széles architektúrákat is bejelentettek. Az Apple pl. nagyon korán (2013-ban) 6 széles magot mutatott be (Jim Keller fejlesztése).

6. fejezet

Disszipációkezelés

6.1. A disszipációkezelés fontossága

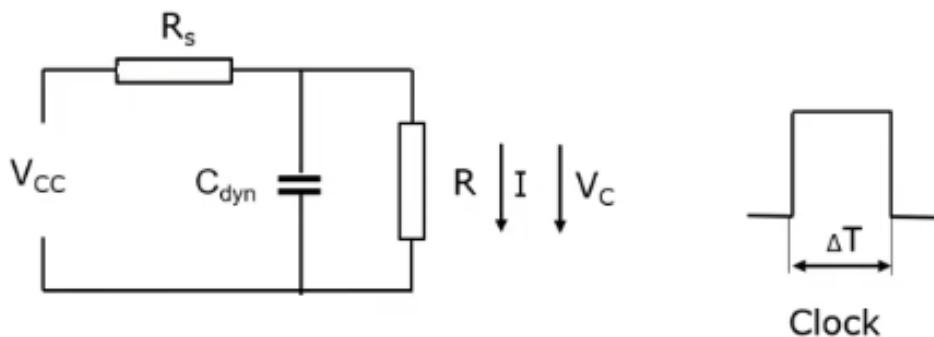
A processzorok fejlesztésének két iránya van: teljesítmény növelése és a fogyasztás csökkentése. A fejlesztés fókusza folyamatosan a disszipáció csökkentése felé tolódott, mivel rájöttek, hogy a teljesítmény fő korlátja a disszipáció.

6.2. A disszipáció

A disszipáció két komponensből áll: dinamikus (működés közbeni) és statikus. A tápegység szempontjából a processzor egy szort kapacitás, amit a felfutó órajelen fel kell tölteni, a lefutón pedig egy ellenálláson keresztül le kell vezetni. A töltés-kisülés fogyasztása a dinamikus disszipáció. A statikus disszipáció a lezárt tranzisztorok szivárgási áramából adódik. A teljes disszipáció a kettő összege.

6.2.1. Kiszámítása

A dinamikus disszipáció kiszámításához a processzor aktív tranzisztorait egy áramkörrel modellezhetjük (6.1.).



6.1. ábra. Aktív tranzisztorok modellje

Ebből a dinamikus disszipáció kiszámítása:

$$D_d = 2 * C_{dyn} * V_{cc}^2 * f_c \quad (6.1)$$

Az órafrekvenciával lineáris, mivel a töltés-kisülések mennyisége függ tőle.

6.3. TDP

Thermal Design Power, azaz tervezési hőérték. Egy számításigényes alkalmazás futtatása közbeni maximális disszipációt jelenti. Fontos, hogy nem teljesen pontos érték. Az OEM-ek ez alapján tervezik a hűtés rendszereket, aminek legalább ezt a TDP értéket el kell vezetnie úgy, hogy a tranzisztorok hőmérséklete nem megy kb. 80-90°C fölé. A kategóriák jellemző TDP értékeit mutatja a 6.2. ábra.

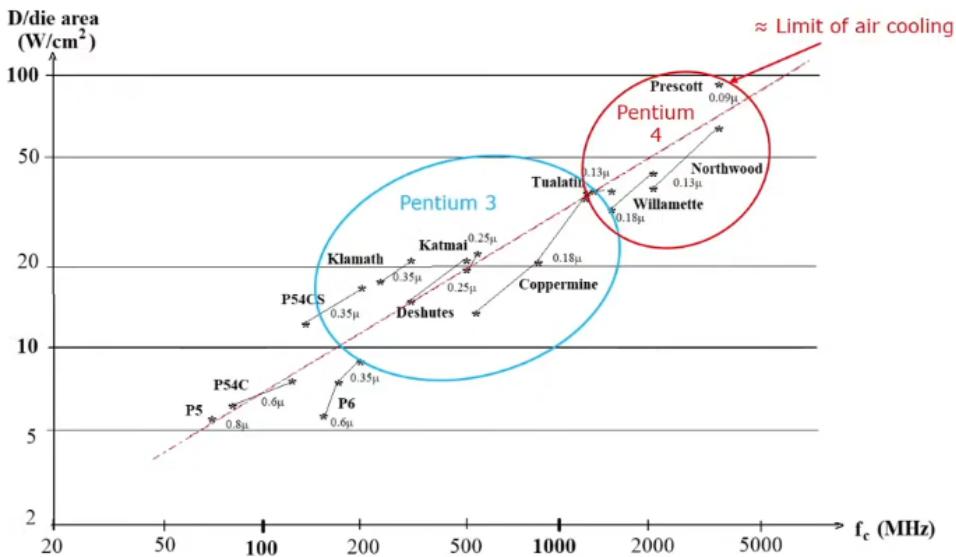
Processor category	TDP	Intel's usual tags
Servers	≈85-200 W	
HEDs	≈100-150 W	X
Desktops	High perf.	≈70-95 W K
	Mainstream	≈50-65 W S
	Low power	≈35-45W T
	High perf.	≈45 W H/HQ
Notebooks	Mainstream	≈25-35 W U
	Ultra-thin	≈15 W U
Tablets	≈5 W	Y/m

6.2. ábra. Processzor osztályok jellemző disszipációja

A TDP korlátozza az alapfrekvenciát. A Turbo működéséhez jóval több watt szükséges.

6.4. Intel processzorok disszipációja a fejlődés során

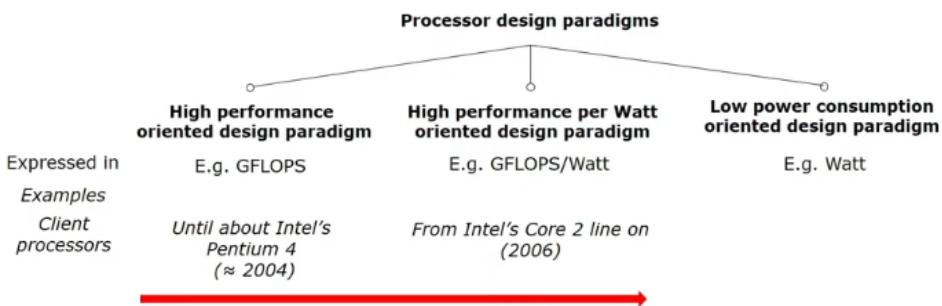
A 6.3. ábrán az Intel processzorok lapkamérethez viszonyított disszipációjának növekedése látható az órajel növekedésével.



6.3. ábra. Disszipáció változása az órajel függvényében

Látható, hogy a Pentium 4 Prescott mag már közel 100 wattot adott le cm^2 -enként, ami a léghűtés fizikai határa. Az Intel 2000-ben azt várt a Pentium 4 családtól, hogy 10 évig gyártásban marad és 10 GHz órajelet fog elérni. Ehelyett 2004-ben 4 GHz-nél megakadt a fejlesztés. A Prescott család bizonyos tagjait kényetlenek voltak visszavonni túlmelegedési problémák miatt.

Ezzel az Intel 2003-tól a nyers teljesítményről áthelyezte a hangsúlyt a teljesítmény per watt, azaz a hatékonyság növelésére. Összefoglalva a tervezési paradigmák változását mutatja a 6.4. ábra.



6.4. ábra. Processzor tervezési paradigmák

6.5. Disszipációcsökkentő kezdeményezések

A disszipáció kezelésére megszületett az Energy Star kezdeményezés, az AMD pedig célul tűzte ki, hogy 2014 és 2020 között 20x-osára emeli a hatékonyságot.

6.5.1. Energy Star

Az amerikai környezetvédelmi hatóság indította 1992-ben, az energiatudatosság elterjesztésére a processzoroknál. Több verziója volt, a legfontosabb az 5., amit 2009-ben adtak ki, a Pentium 4 problémái

után. Lényege, hogy a processzorokra kiszámítják az éves inaktív állapotú energiafogyasztást, és ha egy modell a határérték alatt van, akkor használhatja az Energy Star jelölést. A különböző inaktív állapotok súlyozása kategóriánként eltér.

6.5.2. Az AMD hatékonyiségi kezdeményezése

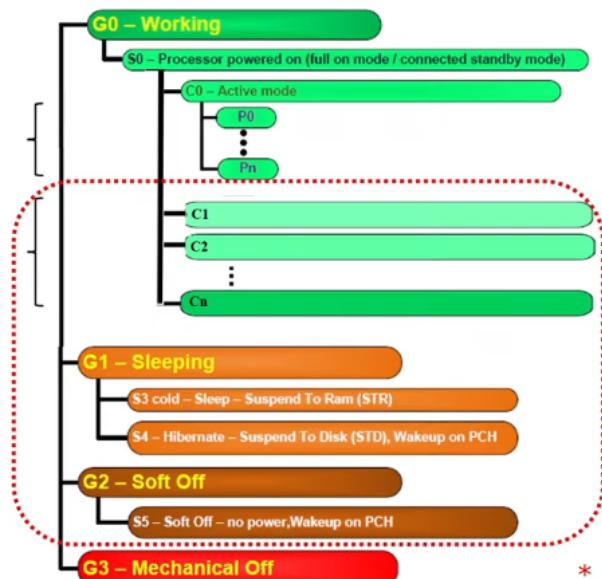
2014-ben jelentették be, hogy növelni szeretnék a teljesítmény per watt arányt. 2009-től 2014-ig 10x-es hatékonyág növekedést értek el, ehhez képest szerettek volna további 25x-ös javulást 2020-ra. 2020-ban bejelentették, hogy a Zen 2 alapú Ryzen processzoraikkal elértek a célt, 32x-es növekedéssel.

6.5.3. Szerverek energiahatékonyisége

A szervereknél kiemelten fontos a hatékonyág, mivel egy adatközpont több MW áramot is fogyaszthat. A szuperszámítógépeket hatékonyág szerint is rangsorolják, erre szolgál a Green500-as lista.

6.6. ACPI

Az inaktív állapot definiálása az Energy Star-hoz az ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) szabvány segítségével lehetséges. Ez egy nyílt szabvány, ami definiálja a számítógép állapotait. Az állapotot globális (Gi), teljesítmény (Pi), inaktív (Ci) és alvó (G3) állapotok jellemzik (6.5. ábra).



6.5. ábra. ACPI állapotok

Globális állapotok:

- G1: OS által kezdeményezett leállás, kontextus mentéssel
- G2: OS által kezdeményezett leállás, kontextus mentés nélkül, tápellátás megmarad
- G3: mechanikai kikapcsolás

6.7. A disszipációkezelés technikái

A disszipáció kezelése sokféleképpen történhet, a tranzisztorok tervezésétől az áramkörökön és a processzoron át egészen a platform és operációs rendszer szintekig.

6.7.1. Kezelés áramköri szinten

Két jelentős technológia:

- óra kapuzás
- tápfeszültség kapuzás

Óra kapuzás

Az éppen inaktív áramkörök elé egy AND kapu kerül, ami inaktivitás esetén nem küld órajelet az áramkörre, így csökkentve a fogyasztást. A statikus disszipáció viszont továbbra is fennmarad. Implementációja történhet finom vagy durva szemcsézettséggel. A finomnál kis áramköri egységeket külön-külön kapuznak, míg a durva szemcsézs több modult kapoz egyszerre. Az óra kapuzást korán, már 1996-ban is alkalmazta a DEC cég az Alpha processzoraiban (lebegőpontos egységeket kapuzták). Mivel a technológia jól bevált, hamar elterjedt, az Intel a Pentium 4-től használja, ma már teljesen általános.

Tápellátás kapuzása

Az óra kapuzás továbbfejlesztése, nagyobb áramköri egységekre használják mint pl. mag vagy memória kontroller. Az egység inaktivitása esetén a komplett tápellátást lekapcsolja az egységről, így a dinamikus és a statikus disszipációt is megszüntetve. A többmagos processzorokban a processzormagok külön-külön kapuzhatók.

A tápfeszültség kapuzás előfeltétele a Turbo Boost technológiának, mivel a Turbo órajel a processzor fogyasztása és a TDP közötti hőtartalékot felhasználva emeli meg az órajelet. Ehhez elegendő hőtartalékot kell biztosítani, amit nagyban elősegít a kapuzás.

A tápellátás kapuzást az Intel vezette be a Nehalem processzorokkal 2008-ban. Később az AMD és az IBM is átvette.

Implementáció szerint először (Nehalem) csak a magokat kapuzták, később több egységre is kiterjedt mint pl. L3 cache, GPU, memória kontroller. Az Intel a Westmere, Sandy Bridge és Ivy Bridge folyamatosan terjesztette ki a kapuzást, az AMD a Bulldozer családdal gyakorlatilag minden alapegységet kapuzott.

A tápellátás megszüntetése történhet a pozitív pólus vagy a föld elvágásával is.

Integrált tápegeységek - Intel FIVR

Az Intel a Haswell családdal továbbfejlesztette az energiaellátást, a tápegeység (voltage regulator) bizonyos részeinek processzorlapkára helyezésével. Ez a FIVR (Fully Integrated Voltage Regulator), ami eltérő feszültséggel tudja ellátni a processzor különböző részeit, így a kapuzás fölöslegessé vált.

Ezt a technológiát a Haswell és Broadwell processzorok után felfüggesztették, mivel az integrált tápegeység a processzor disszipációjához adott hozzá, így csökkentve az elérhető órajelet. A Skylake-el kezdődően tehát ideiglenesen visszatértek a teljesítmény kapuzásra.

Feszültség lekapcsolás előkészítése

Mielőtt egy magról lekapcsolnánk a tápot, a gyorsítótárat vissza kell írni a következő szintű gyorsítótárba, vagy ha az nem elérhető, memóriába. A processzor végrehajtási állapotát (kontextus, azaz a regiszterek állapota) is el kell menteni egy következő szintű cache-be, vagy a memóriába, esetleg SRAM-ba. A táp lekapcsolással együtt a magról lekapcsolják az órajelet és az órajel generátort is.

A kontextus mentése

A kontextus mentése történhet:

- memóriába (AMD használta pl. Bulldozer, Piledriver, Excavator, Bobcat, Jaguar)
- következő szintű gyorsítótárba (AMD Jaguar, Puma)
- magonkénti SRAM-ba (Intel processzorok)

6.7.2. Kezelés platform szinten

Platform szinten bonyolult a disszipáció kezelés, mivel részt vesz benne a processzor, az IO eszközök, a BIOS és az OS is. Az első ilyen megoldások az Intel-től származnak (SL), később a Microsofttal összefogva fejlesztettek (APM, nem terjedt el). Később több gyártó is bekapsolódott, így alakult ki a nyitott ACPI szabvány (1996-tól máig használják).

Az ACPI fejlődése

Az ACPI 1.0 verziót a Windows 95, 98, 2000 és NT 4.0 rendszerek támogatták. Az XP és a Server 2003 rendszerek már az ACPI 2.0-t használták, amiben már jelen volt a DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling) és nagyban elősegítette a disszipáció kezelését. A többmagos és többszálas rendszerek támogatása az ACPI 3.0-ban jelent meg, ezt a Vista, 7 és Server 2008 operációs rendszerek használták. A 4.0 kevésbé jelentős, de az 5.0 egy új szemléletet vezetett be: Collaborative Processor Performance Control, aminek során az operációs rendszer csak átadja a processzornak, hogy a felhasználó a teljesítményt vagy az alacsony fogyasztást preferálja, majd ezután a többi döntést a processzor hozza meg hardveresen. A fejlődés folytatódott, de a 6-os verziónak nem voltak jelentős újításai.

6.7.3. Kezelés CPU szinten

Kétféle kezelési lehetőség:

- aktív magok kezelési technikái:
 - energiaszükséglet csökkentése:
 - * DVFS - dinamikus feszültség és frekvencia kezelés
 - * CPPC
 - * AVFS - adaptív feszültség és frekvencia kezelése
 - Turbo Boost: a TDP hőtartalékát felhasználva megemeli a processzor az alap frekvenciáját ideiglenesen
- inaktív magok kezelési technikái (ACPI alapú, C állapotban keresztül): a kihasználatlan magot egyre mélyebb alvó állapotba helyezi a rendszer.

DVFS - Dynamic Voltage and Frequency Scaling

Egymagos rendszerek

A DVFS (egymagos, egyszálas processzoroknál) alapelvei:

- a dinamikus fogyasztás kiszámítása:

$$D_d = \text{const} * V_{cc}^2 * f_c$$

- a szükséges magfeszültség (V_{cc}) ahhoz, hogy stabil órajelet lehessen generálni közel egyenesen arányos az órafrekvenciával

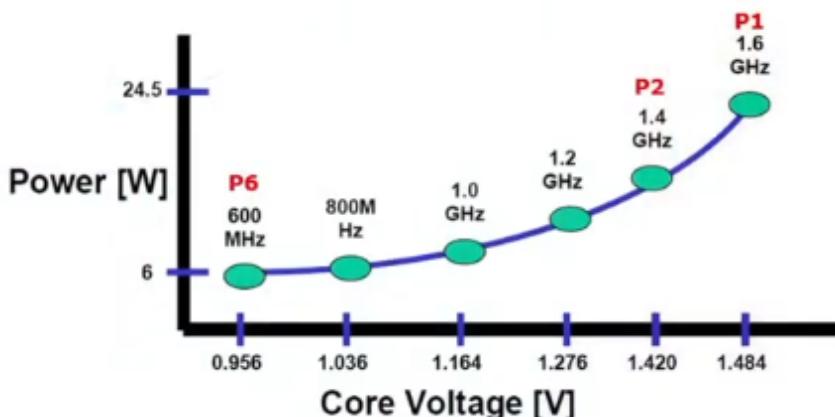
$$V_{cc} = \text{const} * f_c$$

- tehát a dinamikus disszipáció közel köbösen aránylik a frekvenciához:

$$D_d = \text{const} * f_c^3$$

Következmény, hogy a disszipáció csökkentésére nagyon hatékony eszköz a frekvencia csökkentése. Fontos, hogy a frekvencia csak addig csökkenthető, amíg ez nem rontja a felhasználói élményt.

A DVFS a P (performance) állapotokon alapul, amiket az ACPI 2. verziója tartalmazott. A P állapotok munkapontok, amik a magfrekvencia és órafrekvencia kettősöket adják meg (6.6. ábra).



6.6. ábra. Az Intel Pentium M processzor munkapontjai

Látható, hogy a legalacsonyabb állapotban csak 6 watt a disszipáció, a legmagasabbban pedig már 24.5 watt. A cél tehát a lehető legalacsonyabb fogyasztású P állapotban tartani a processzort, ha ez megtehető a felhasználói élmény rontása nélkül. A legmagasabb teljesítményű és fogyasztású állapot a P1.

Itt nagyon fontos szerepet kap az OS, mivel neki kell eldöntenie, hogy melyik az a P állapot, ami még nem rontja érezhetően a teljesítményt. Ehhez az OS vizsgálja a CPU kihasználtságát: megnézi, hogy egy adott időablakot az ütemező hány százalékban használ ki. Pl.: ha a CPU mag 2 GHz-en működik, de a kihasználtság csak 50%, akkor minden második óraciklus elvesztegetett. Ezért a frekvencia lehívhető 1 GHz-re, érezhető lassulás nélkül. Ez alapján az OS kiválasztja a P állapotok közül az optimális munkapontot. Ha megtörtént a kiválasztás, az OS a CPU-val egy regiszter interfésszen keresztül közli a döntést. Ezt az interfést az ACPI standard határozza meg. Ezután ezt a regisztert lekérdezi a PCU (Power Control Unit) és beállítja a frekvenciát. Ez a rendszer igényvezérelt skálázást tesz lehetővé.

Többmagos rendszerek

Többmagos rendszereknél az OS a taskokat szálakhoz, és nem magokhoz rendeli. Ezért a kihasználtságot is szálakra vizsgálja. A DVFS lépései több mag és több szál esetén:

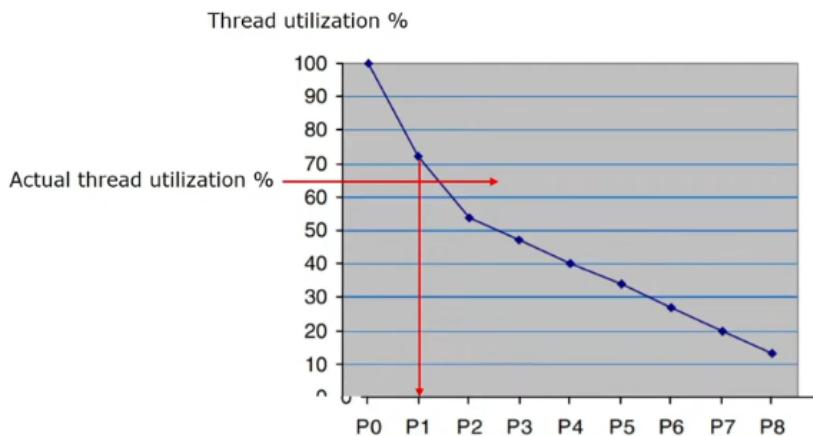
- szál kihasználtság meghatározása
- kihasználtság alapján legjobb P állapot kiválasztása
- ha több szál van egy magon, koordinálni kell a kiválasztott P állapotokat (egy mag csak egy feszültségen működhet)
- az igényelt P állapot kommunikálása a processzorral
- a PCU beállítja az igényelt magfeszültséget és órajelet

Szál kihasználtság meghatározása

Először azt figyelték, hogy az idő hány százalékában nincs ütemezendő szál, viszont ez körülményes volt. Ezért 2006-tól az Intel bevezetett szálanként két gépi 64 bites regisztert, amiket számlálóként használ. A számlálókat csak akkor lépteti a processzor, ha az adott szálhoz tartozó logikai processzor aktív (C0) állapotban van. Az egyik számlálót az alapfrekvencia ütemében inkrementálják, a másikat pedig a pillanatnyi órajel ütemében. A kettő aránya megadja a processzor kihasználtságát.

P állapot meghatározása

A kihasználtság alapján meghatározható a legmegfelelőbb P állapot (6.7. ábra).



6.7. ábra. P állapot meghatározása

Több szál koordinálása egy magon

Ha egy mag több szálat futtat, minden a teljesítmény igényesebb szálhoz kell igazítani a mag állapotát. Ha több mag van egy közös órajelről táplálva, szintén a legnagyobb teljesítmény igényű szálat futtató maghoz kell igazodni. Az újabb rendszerek már képesek magonként különböző P állapotokat kezelní, így a magok közötti koordináció nem szükséges.

Kiválasztott P állapot kommunikációja

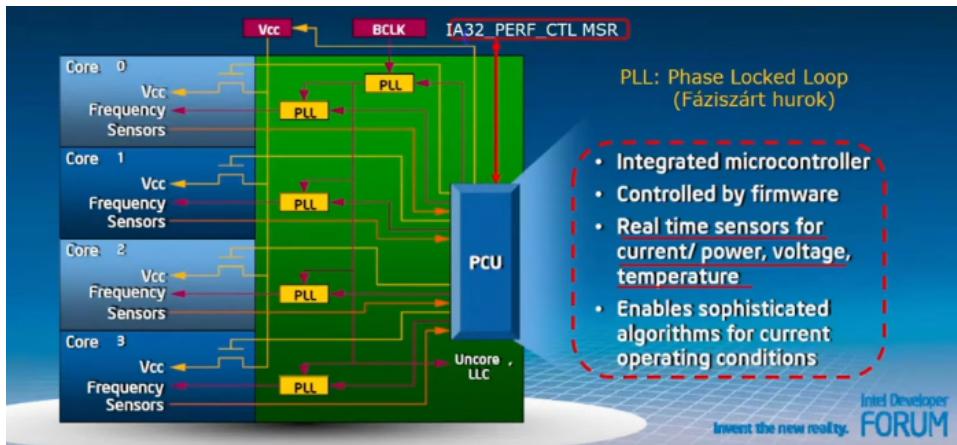
Erre a performance control (IA32_PERF_CTL) belső regiszterek szolgálnak, amibe az OS írhat. A regiszterben az alsó kettő byte szolgál a feszültség és a frekvencia megadására. A frekvencia megadása szorzófaktorral történik, pl. 133 MHz busz frekvenciánál 34-es szorzó 34x133 MHz-t jelent. Ennek a regiszternek a kódolása nem publikus.

PCU működése

A performance control regiszter kiolvasása után a PCU beállítja a szükséges paramétereket.

DVFS az Intel Nehalem processzorokon

A Nehalem mikroarchitektúrára épülő CPU-knál vezették be először a PCU használatát. Működése a 6.8. ábrán látható.



6.8. ábra. PCU az Intel Nehalem processzorokban

A DVFS továbbfejlesztése

A DVFS-nek két továbbfejlesztett változata van:

- CPPC: az OS csak iránymutatással látja el a PCU-t, a precíz feszültség és órajel szabályzást a PCU végzi.
- AVFS: a DVFS biztonsági zónáját csökkenti, a teljesítmény növelése vagy a disszipáció csökkentése érdekében.

A CPPC-t az Intel a 2015-ös Skylake óta használja (SpeedShift), az AMD pedig a 2019-es Zen 2 alapú Ryzen 3000 óta. Az AVFS egy régebbi rendszer, az IBM 2007 óta használja, a Samsung 2015-től (Galaxy S6), az AMD pedig a régebbi processzoraiban.

CPPC - Collaborative Processor Performance Control

A CPPC-t az ACPI 5.0 szabvány definiálja, az ACPI 2.0 alapú DVFS-t váltja le ez a technológia. Ehhez szintén szükséges OS támogatás, ami a Windows 10 2015 őszi frissítésével jelent meg.

A DVFS-nél az OS nézi a kihasználtságot és küldi el a szükséges P állapot paramétereit. Hátránya, hogy a kihasználtság vizsgálata nagy időablakban történik, így a rendszer lassú, csak ritkán tudja módosítani a P állapotokat. A gyorsításához a lehető legjobban ki kell küszöbölni az OS-t, erre szolgál a CPPT. Ez a gyorsulás látszik a 6.9. ábrán.

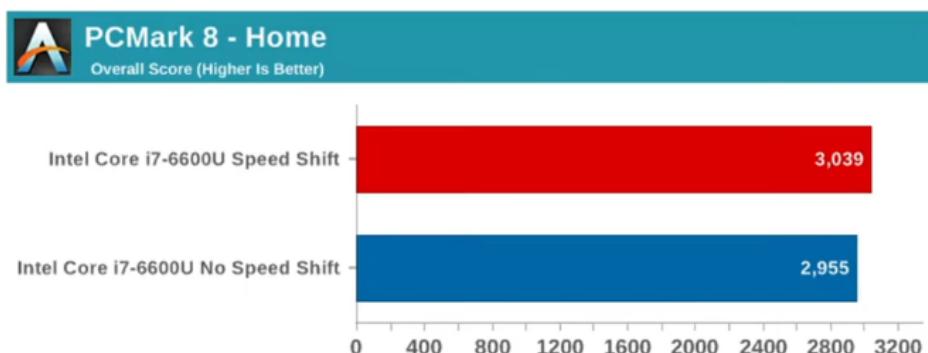


6.9. ábra. Intel SpeedShift (CPPC) és DVFS frekvencia átállási ideje

A CPPC-nél az OS csak felhasználói igényeket továbbít, mint pl. a teljesítmény vagy a fogyasztás preferálása. Ezután a vezérlést átadja a PCU-nak, ami önállóan beállítja a szükséges paramétereket, valamint végrehajt optimalizációkat is. Az optimalizálásokat több algoritmus segítségével hajtja végre. Az operációs rendszer felügyeli a PCU működését és hiba esetén beavatkozhat.

További fejlesztés még a DVFS-hez képest, hogy a diszkrét munkapontok helyett bármilyen szorzó beállítható. Ezzel finomabb szabályozás valósítható meg.

Az alacsonyabb felfutási időnek köszönhetően a CPPC segítségével nagyobb teljesítmény érhető el (???. ábra).



6.10. ábra. Benchmark eredmények CPPC-vel és anélkül

A teljesítmény javulása viszont nem számottevő (kb 1.5%). Más alkalmazásoknál kb. 20% javulás érhető el. A további gyorsításért az Intel a Kaby Lake processzorokban javított a SpeedShift technológián, a korábbi 35 ms-os felfutási időt 10 ms-re csökkentették.

Az AMD CPPC Implementációja már egy korszerűsített CPPC változatot valósít meg, ami az ACPI 5.1 szabványból származik. A felfutási időt az AMD 1 ms környékére csökkentette.

AVFS

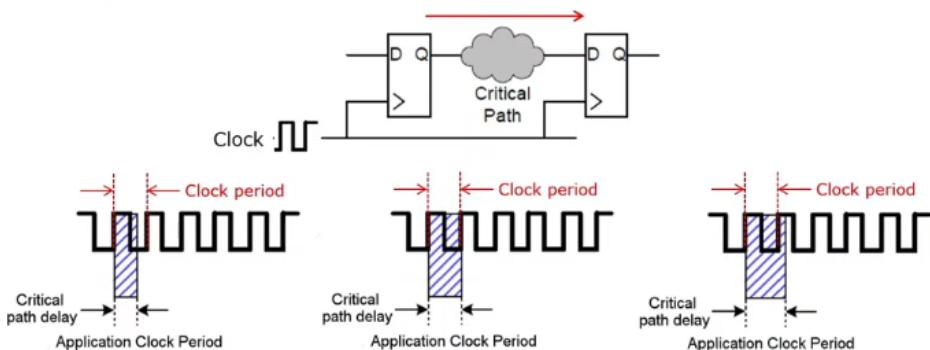
A DVFS-nél az OS előre meghatározott frekvencia-feszültség párosokból választ működési pontokat. Ezeket a működési pontokat minden CPU fejlesztése során mérésekkel határozzák meg (adott frekvenciához melyik az a legkisebb feszültség, amin még stabilan működik a CPU), majd ezt egy biztonsági értékkal növelik (guard band), hogy rosszabb körülmények is jó legyen a CPU. Ilyen körülmények pl.:

- gyártási eljárás miatti eltérések
- processzor belséjében tápfeszültségek eltérései

- processzor hőmérséklete
- processzor öregedése

A gyártási eljárás figyelembe vétele nél azokkal a legyártott darabokkal kell számolni, amiknek a legmagasabb a minimum magfeszültsége. Probléma, hogy mindenek miatt a biztonsági sávot nagyon nagynak kell megválasztani.

Az AVFS erre jelent megoldást, csökkenti a szükséges biztonsági sávot. Alapja, hogy nem a legrosszabb esetet veszük figyelembe, hanem helyben történik a minimális feszültség meghatározása. A helyi mérés kritikus út monitorokkal valósul meg, tehát a kritikus áramköri részeken áthaladó jeleket méri a processzor és hasonlítja össze az órajellel. Ha a jel hamarabb érkezik meg, mint a következő órajel, akkor még növelhető a frekvencia vagy csökkenthető a feszültség. Ha pont egyszerre, akkor elérte a jó beállítást. Ha pedig később érkezik meg a vizsgált jel, mint az órajel, akkor csökkenteni kell a frekvenciát, vagy növelni a feszültséget. Ezeket az eseteket mutatja a 6.11. ábra.



6.11. ábra. Órajel és frekvencia beállítása kritikus út monitorozással

Az AVFS a kritikus út monitorok jelzései alapján be tud állítani egy, a gyártásnál meghatározottnál jóval kisebb biztonsági sávot. Ezzel jelentős mértékben csökkenthető a fogyasztás, vagy növelhető a teljesítmény.

Az AVFS kétféleképpen használható fel: AVS és AFS. Az AVS (Adaptive Voltage Scaling vagy undervolting) a csökkentett biztonsági sávot az előre meghatározott P állapotok feszültség értékeinek meghatározására használja, így csökkentve a fogyasztást. Az AFS (Adaptive Frequency Scaling vagy overclocking) viszont a P állapotokhoz tartozó frekvenciákat növeli meg, így növelte a teljesítményt.

6.8. Az Intel Turbo Boost technológiája

6.8.1. Bevezetés

Az Intel a Nehalem-nél (2008) vezette be a Turbo Boost első verzióját. Ezután két másik verziót hoztak ki: 2.0 (Sandy Bridge, 2011) és 3.0 (Broadwell-E, 2016).

6.8.2. Első generáció

A Turbo Boost 1.0 nagyrészt a TDP-re alapoz. Ha a processzor aktuális disszipációja alacsonyabb, mint a TDP pl. kis számítási igényű alkalmazások futtatásánál, a Turbo Boost megemeli az aktív magok órajeleit. Így ha pl. négy mag közül csak kettő aktív, az inaktív magok által nem elhasznált disszipáció átadható az aktív magoknak, amik így magasabb teljesítményen működhetnek.

A Turbo Boost-al együtt jelent meg a PCU is. Feladatai:

- DVFS kezelése
- Turbo Boost vezérlés
- a teljes disszipáció és a hőmérséklet ellenőrzése, szükség esetén a frekvencia csökkentése

A Turbo Boost aktiválásához négy feltételnek kell teljesülnie:

- az OS igényli a legmagasabb teljesítményű (P0) állapotot
- az aktuális fogyasztás kisebb mint a TDP
- az aktuális áram egy megadott érték alatt van
- a lapka hőmérséklete egy megadott érték alatt van

Ha ezek teljesülnek, a PCU megnöveli a frekvenciát és így a teljesítményt. Ehhez tudnia kell a PCU-nak, hogy milyen Turbo frekvenciát válasszon. Az első generációban ez az aktív magok függvénye (kevesebb aktív mag = alacsonyabb Turbo órajel és fordítva). A maximális Turbo Boost órajeleket a gyártás során határozzák meg, szorzófaktorok formájában. Ezeket a szorzókat az MSR 1ADH regiszterben tárolja a processzor (Model Specific Register).

7. fejezet

Az AMD Zen processzorai

7.1. Bevezetés

Az AMD a korábbi lemaradás után az utóbbi években újra felzárkózott az Intelhez és több kategóriában megverte őket teljesítményben. A Zen elnevezés vonatkozhat általában a Zen mikroarchitektúrára épülő processzorokra és az első generációs Zen CPU-kra is. A fejezetben ezért az első generációs Zeneknél explicit jelöljük a generációt. A gyártó a mobil elnevezést a laptop processzorokra használja.

7.2. Áttekintés

Az 1960-as években a Fairchild Semiconductor vállalatból több cég kivált, de ezek közül csak az Intel és az AMD nem olvadt be más cégekbe. Napjainkban ez a kettő határozza meg az x86 alapú processzorgyártást.

Az AMD először az Inteltől licenszelt processzorokat gyártott, 1996-ban a K5 processzorokkal jelentek meg a saját fejlesztésű termékeik. A K8 a világ első 64 bites processzora volt (2003). Ezután több, nem túl sikeres processzort gyártottak (Bulldozer, Cat), az újabb siker 2017-ben jött a Zen családdal.

Az AMD jelentőségteljes fejlesztései közé tartozik az x86-os utasításkészlet 64 bites kiterjesztése. Ekkor az Intel és a HP 64 bites VLIW architektúrával próbálkozott (Itanium), az AMD viszont a meglévő x86-os architektúra kiterjesztésében látta a jövőt. Ebből az AMD került ki győztesen. A 64 bit megvalósításához ki kellett terjeszteni a regisztereket és az utasításokat is ki kellett bővíteni.

Az AMD másik fontos fejlesztése a DCA (Direct Connect Architecture) multiprocesszoros megoldás. Ezzel a korábban az északi hídon lévő memóriavezérlőt integrálták a processzorlapkára, kiküszöbölvé a memória szűk keresztmetszetét (főleg szervereknél volt probléma). A DCA része még a HyperTransport link, amiből minden processzorra kerül három és a processzorok összekötését szolgálják.

A fejlesztéseknek köszönhetően az AMD 2003-ban megjelent processzorai teljesítményben jobbak voltak az Intelénél. Így egyre nagyobb piacot tudott magának szerezni. Az Intel csak később vette át ezeket az újításokat, de végül ők is rákényszerültek az x86 64 bites kiterjesztésére (2004). A lapkára integrált memóriavezérlőt viszont csak 2008-ban hozta be az Intel a Nehalem processzorokkal.

Az AMD piaci részesedése viszont 2006-tól csökkenni kezdett, mikor az Intel kihozta a Core 2 processzorait és az AMD elő került teljesítményben. Ez a tendencia 2017-ben fordult meg, az AMD Zen processzorok megjelenésével. A Zennel nagy mértékű teljesítmény és hatékonyság növekedést értek el, 2021 elején egymagos teljesítményt nézve az AMD Ryzen 9 5900X volt a leggyorsabb asztali processzor.

A szervereknél szintén az AMD EPYC processzorok vezetik a benchmarkokat. Az Intel eléggyé elmarad, viszont közben megjelentek az ARM alapú szerverek, amik teljesítményben majdnem elérik az AMD-t. Az ARM architektúrák teljesítmény felvételben kedvezőbbnek tűnnék, tehát valós konkurencia az x86-nak.

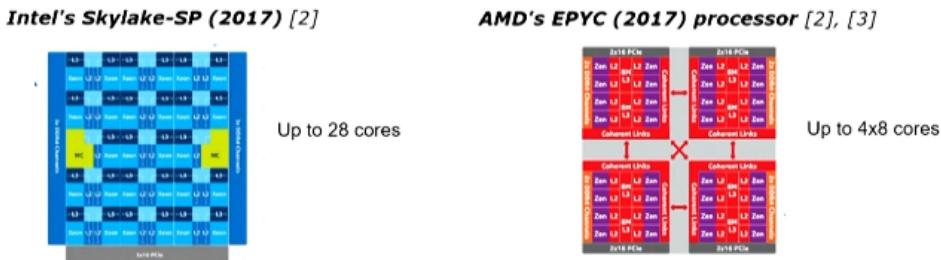
7.3. A Zen család tervezési elvei

Az AMD 300 mérnöke dolgozott a Zen mikroarchitektúrán, hogy teljesítményben legyőzzék az Intelt. A megvalósítási alapelvek:

- többlapkás megközelítés
- lego-jellegű rendszer, három különböző lapkatípusból lehet összerakni a processzorokat:
 - CPU lapkák
 - APU lapkák - számítási és grafikai feldolgozást is megvalósít
 - IO lapkák
- három szintű hierarchikus tervezés
- a lapkák összekötéséhez szükséges egy új kapcsolóhálózat kifejlesztése, ez lett az Infinity Fabric (IF)
- a lapkákat egybe kell tokozni, ehhez egy két dimenziós tokozást alkalmaztak (MCM - Multi Chip Module)

7.3.1. Többlapkás felépítés

Korábban a processzorokat monolitikusan terveztek, azaz minden mag egy lapkára került. Ilyen az Intel Skylake-SP (2017) is, ami 28 magot tartalmaz egy lapkán. Az AMD EPYC (2017) viszont többlapkás megvalósítást használ, négy, egyenként nyolc magos lapkát tartalmaz egy tokozásban (7.1).



7.1. ábra. Monolitikus és többlapkás felépítés

A többlapkás felépítés fő előnye, hogy kisebb lapkák gyártásával kisebb a hibaarány, így nagyobb lesz a kihozatal, tehát a gyártás költséghatékonyabb. Az AMD becslése szerint egy 32 magos processzornál a többlapkás felépítés gyártási költsége mindössze 60%-a az egylapkás felépítésűnek. További előny, hogy ugyanazokból az alapelemekből több processzort is ki lehet alakítani, valamint a memória csatornák és az IO skálázható a magok számával.

Hátrány viszont, hogy egy cache koherens összekapcsoló hálózat kell, ami csökkenti a teljesítményt és növeli a fogyasztást. Ezen kívül a tokozás növeli a gyártási költségeket.

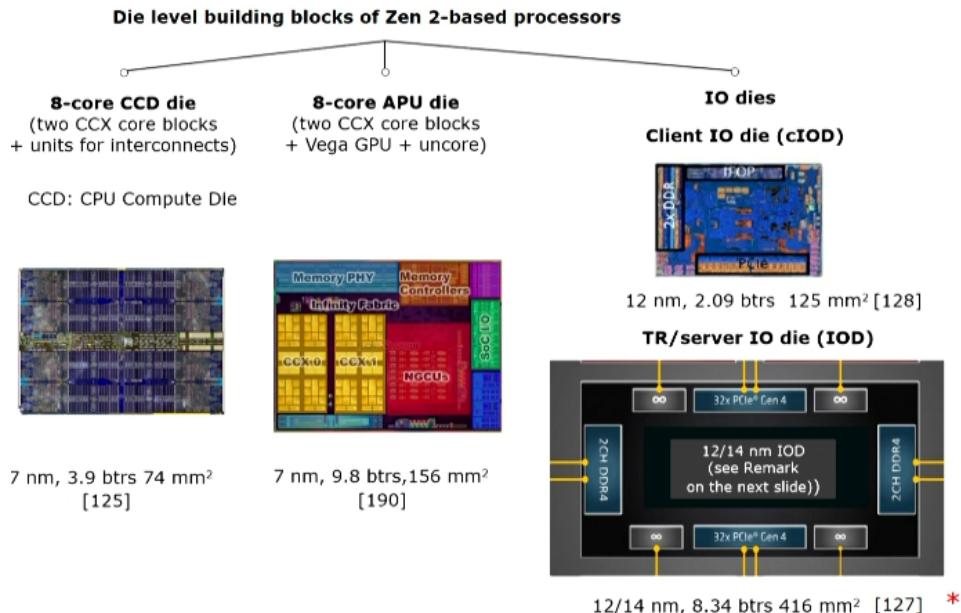
A többlapkás felépítést az Intel is tervez átvenni, valamint az Nvidia is végez kutatásokat a GPU-k többlapkás felépítésével kapcsolatban.

7.3.2. Moduláris kialakítás

A teljes Zen család három fajta lapkából épül fel (CPU, APU és IO).

A CPU lapkák nem tartalmaznak GPU-t. Az első generációban Zeppelinnek, később CCD-nek (CPU Compute Dies) hívták. Az APU lapkák CPU-t és integrált GPU-t is tartalmaznak, az IO lapkák pedig az IO-ért felelnek. IO lapkáknál megkülönböztetünk szerverekben és HEDT gépekben használt IOD-okat (IO Dies) és kliensekben használt cIOD-okat (Client IO Dies).

Az asztali processzorok, a HEDT-ek és a szerverek nem tartalmaznak grafikát, több lapkából állnak és tartalmaznak IO lapkát is. Ezzel szemben a laptopokba és asztali gépekre szánt APU-k egy lapkás SoC-ök, GPU-t is tartalmaznak. A különböző lapkatípusokat mutatja be a 7.2. ábra.



7.2. ábra. A Zen 2 processzorokat alkotó lapkák

A mobil és desktop APU-k egy APU lapkából állnak, legfeljebb 8 maggal (Ryzen 4xxU/H/HS és Ryzen 4xxG/GE). A GPU nélküli desktopok (Ryzen 3xxx/X) 1 vagy 2 CCD lapkát és 1 cIOD lapkát tartalmaznak (max 16 mag). 24 és 32 magos HEDT processzoroknál 4 darab 6 vagy 8 aktivált magos CCD és 1 IOD lapka van a foglalatban, 64 magnál pedig 8 darab 8 magos CCD és 1 IOD (Threadripper 39xxX). Szervereknél 24 és 32 mag esetében 4 darab 4 vagy 6 magos CCD és 1 IOD, 48 és 64 magnál pedig 8 darab 4 vagy 6 magos CCD és 1 IOD dolgozik.

7.3.3. A CPU-k és GPU-k három szintű hierarchikus tervezése

Az AMD a CPU és GPU lapkákat hierarchikus módon tervezte. Jelentése, hogy az alap építőkocka a mag, a magok összerakásából funkcionális egységek építhetők, a funkcionális egységekből pedig lapkák.

Ezek az építőkockák:

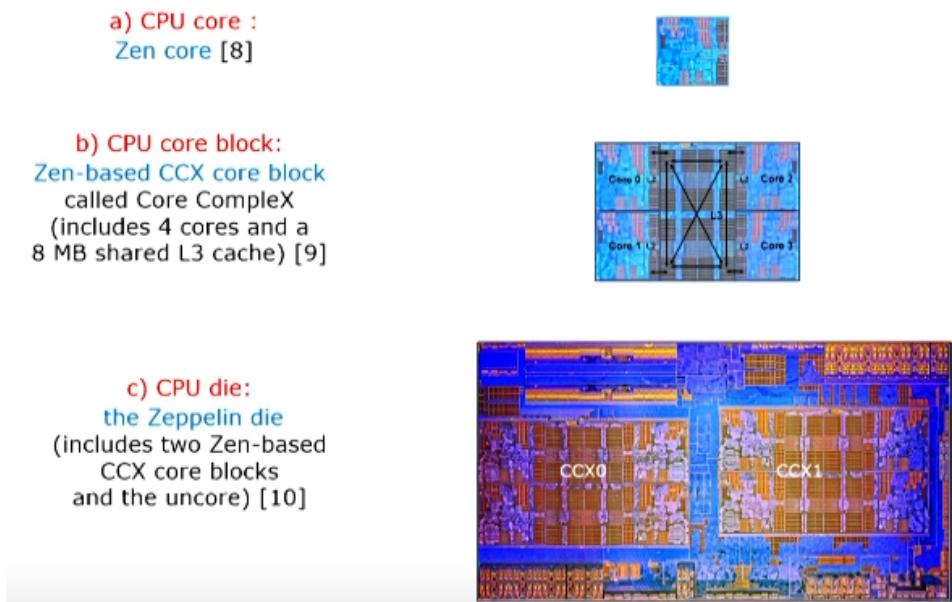
- CPU: CPU magok, CPU mag blokkok, CPU lapkák
- Grafika: GPU magok, GPU, APU lapka (egy GPU és egy vagy két CPU mag blokk)
- IO: csak kétféle lapka (HEDT/szerver és kliens)

A CPU építőelemei

A CPU magok a Zen processzorok alap építőelemei. Ezekből alakulnak ki a CPU blokkok, amik 4 vagy 8 magot tartalmaz. A magoknak saját L1 és L2 gyorsítótárai vannak, az L3 cache viszont osztott és szeletelt. A szeletek egymás mellett párhuzamosan képesek dolgozni. A magcsoportok neve CCV (Core CompleX). A harmadik szint a lapka szint, a lapka egy vagy két CCX-et tartalmaz. Az első generációs CPU-kat Zeppelin lapkának hívták, később CCD-re (Core Complex Dies) nevezték át.

Az Intel ezzel szemben nem magcsoportokat használt, hanem szimmetrikus többmagos rendszereket épített. 2020-ban az Intel viszont a Lakefield családdal áttért a magblokkok használatára és a big.little felépítésre, többlapkás felépítést használva.

A 7.3. ábrán látható egy példa a CPU hierarchikus felépítésére.



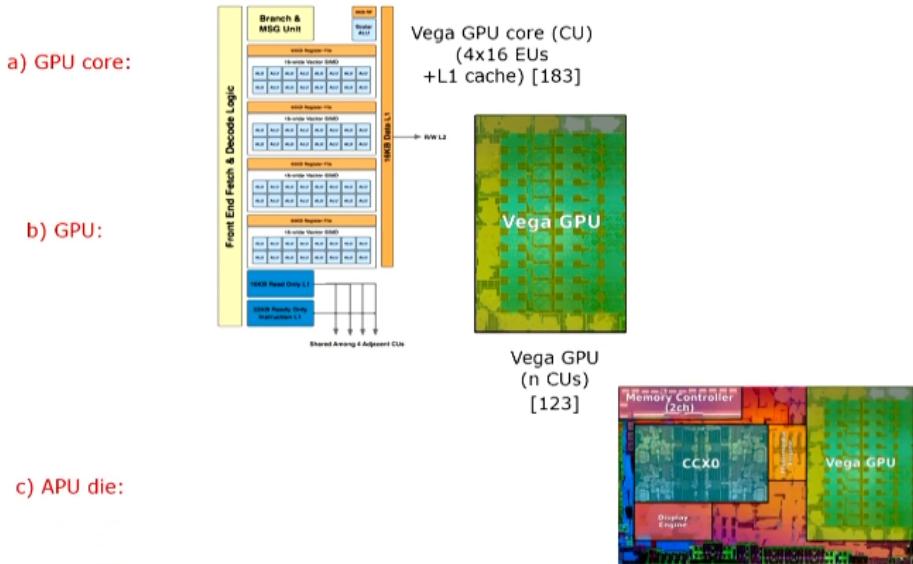
7.3. ábra. A Zen 1 processzorok felépítése

A GPU építőelemei

Itt az alap építőelem a GPU mag, ami megegyezik az AMD diszkrét videokártyáiban használt Vega CU-kkal (Compute Unit). A második szint a Vega GPU-k amik 3-11 Vega CU-t tartalmaznak és egyéb szükséges egységeket. Harmadik szinten az APU lapka van, ami egy Vega GPU-t és egy vagy két CCX-et tartalmaz.

Az APU-nak a GPU-n és CCX-en kívül szüksége van egyéb blokkokra a működéshez, ezeket összefoglalva uncore-nak nevezzük.

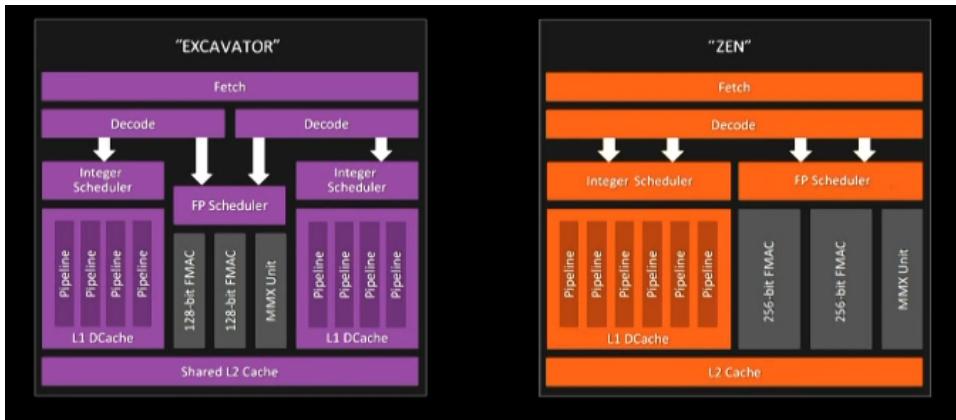
Egy APU felépítése látható a 7.4. ábrán. A 7.4. ábrán látható egy példa a CPU hierarchikus felépítésére.



7.4. ábra. Az APU SoC felépítése

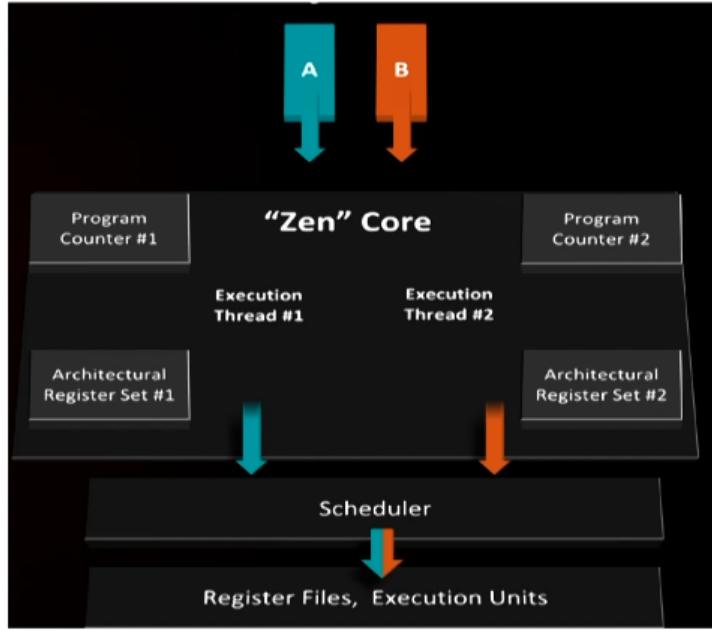
7.4. A Zen magok fejlődése

A Bulldozer processzorokhoz képest több téren előrelépést jelentett. A Bulldozer magban két egész feldolgozó egységet integráltak egy lebegőpontos feldolgozóval és ezt a modult tekintették két magosnak. Ez nem vált be, ezért a Zen visszatárt a hagyományos mag felépítéshez (7.5).



7.5. ábra. Különbség a Bulldozer alapú és a Zen architektúrák között

A Bulldozernek gyengéje volt még, hogy nem alkalmazott többszálúságot, a Zen viszont már megvalósította (7.6).



7.6. ábra. Többszálúság a Zen magokban

A harmadik nagy újítás egy olyan műszaki csomag volt, ami segített a disszipáció csökkentésében és a teljesítmény növelésében. Az AMD ezt SenseMI-nak nevezte el és többek között adaptív feszültségszabályzást, Turbo Boostot, frekvencia növelést, neurális hálós elágazásbecslést és intelligens utasítás lehívást valósított meg.

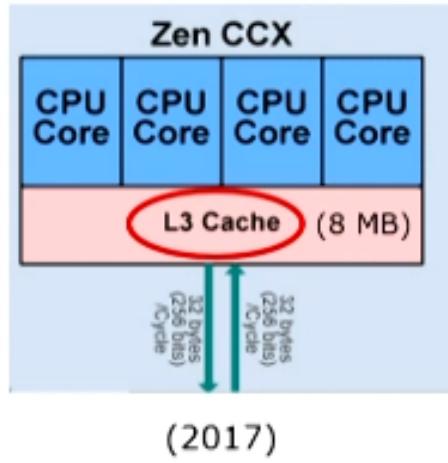
Eredmények:

- 14nm technológia a korábbi 28 helyett
- 52%-os egyszálas teljesítmény javulás
- 3.7x-es javulás teljesítmény/wattban
- többszálúság

A Zen 1 után megjelent a Zen 2 és a Zen 3, 2022-re ígérik a Zen 4-et. A Zen 2-nél 8-ról 16 MB-ra emelték az L3 cache-t és több, kisebb lapkát használtak fel. A Zen 3 még tovább növelte az L3 méretét 32 MB-ra és itt már 4 magos komplexeket használtak.

7.5. A CCX-ek fejlődése

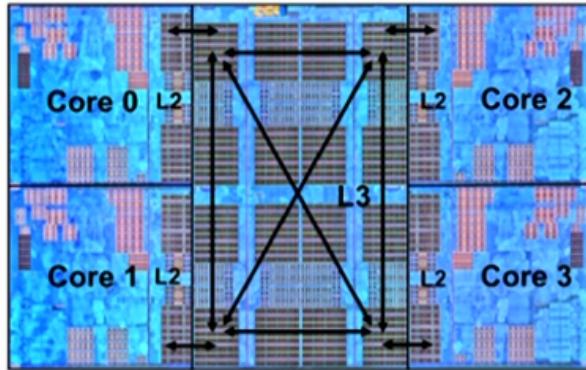
A Zen 1-nél 4 magos CCX-eket alkalmaztak (7.7. ábra)



(2017)

7.7. ábra. Zen 1 CCX felépítése

A magok saját L1 és L2 cache-el rendelkeztek. A CCX 8 MB méretű közös L3 cache-t biztosít a magoknak, a külső komponensekkel pedig egy 32 byte széles, kétirányú linkkel kapcsolódik. Az L3 cache négy darab 2 MB-os szeletre van osztva, amik cím átlapolással címezhetők. A szeletek crossbar kapcsolattal kapcsolódnak, azaz bármelyik mag képes elérni bármelyik szeletet azonos időben (7.8. ábra). Ez többnyire exkluzív cache, tehát az L2-ből kimiradó adatokat tárolja (áldozat cache).



7.8. ábra. Zen L3 cache felépítése

Az ARMv8 ISA szintén magkomplexumokra épül, de megosztott L2 cache-t használ a Zennel ellentétben. Később az ARM (8.2) már szintén privát L2 cache-t használt a magkomplexumoknál. Ezknél már megjelent a big.little architektúra is, azaz kis és nagy magokat kombinálhatnak a magkomplexumok. Az AMD megvalósítása jobb volt mint az ARM 8.0, de elmarad a 8.2-től.

A Zen 2 architektúra megnövelte az L3 cache méretét, két CCX magblokkot tartalmaz és minden magblokknak 4 magja és 16MB L3 cache-e. Itt a két cache összekötését meg kellett oldani, a Zen 3 viszont már közös 32 MB L3 cache-t biztosít a 8 magnak. Ez csökkenti az elérési időket és a mag-mag futási időket.

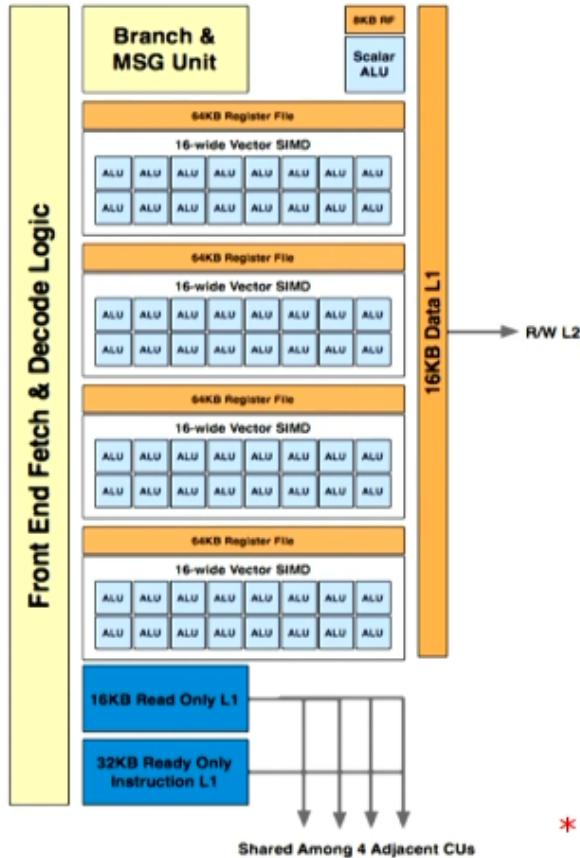
7.6. A grafikai magok fejlődése

Az AMD a Vega számítási egységeit használta fel a Zen processzorokban. A GPU-k változó számú CU-kat (Compute Unit) tartalmazhatnak. A Vega CU architektúrája az AMD GCN (Graphics Core Next)

GPU család 5. generációja, 2017-ben vezették be. Ez már támogatja a mesterséges intelligenciához használt 8 vagy 16 bites adatformátumot is.

7.6.1. A Vega CU felépítése

Minden CU-ban négy SIMD feldolgozó egység van, amikben egyenként 16 ALU van (7.9). A SIMD egységek egymástól függetlenül működnek és ugyanazt az utasítást hajtják végre 16 szálon.



7.9. ábra. A Vega CU felépítése

Minden SIMD egység egy 64 KB-os regiszter fájllal rendelkezik, az ALU-k pedig csak lebegőpontos műveleteket hajtanak végre, ezért kell még egy 32 bites, fixpontos utasításokat végző ALU, ami megosztott a négy SIMD egység között. Az ALU-k lebegőpontos, 32 vagy 64 bites műveleteket tudnak végrehajtani. Ismerik a fused és unfused megoldásokat, a fusednál pl. egy 32 bites szorzás eredménye 64 bit.

Egy Vega GPU több CU-ból áll (3-11 db).

7.7. A Zen processzorok építőelemei és felépítése

7.7.1. Első generáció

Az első generációban kétféle blokkból épültek fel a processzorok:

- 8 magos Zeppelin lapka (2 db 4 magos CCX + uncore)

- 4 magos APU lapka (1 db CCX + uncore)

Ebből a különböző processzor típusok felépítése:

- Mobil APU-k: 1 db APU lapka
- GPU nélküli desktop: 1 db Zeppelin lapka
- HEDT-ek: 2 Zeppelin lapka
- 1S/2S szerverek: 4 Zeppelin lapka

A Zeppelin lapkákat az IF (Infinity Fabric) köti össze és a memóriavezérlők is a lapkákkal együtt skálázódnak.

7.7.2. Második generáció

Itt már három blokkból lehetett válogatni:

- 8 magos, GPU nélküli CCD lapka (két CCX + uncore)
- 8 magos APU lapka (két CCX + Vega + uncore)
- IO lapkák (cIOD - kliens IO lapka vagy IOD - server és HEDT IO lapka)

Ebből felépülő processzorok:

- Mobil és Desktop APU-k: 1 APU lapka
- GPU nélküli desktop: 1 vagy 2 CCD lapka + 1 kliens IO lapka
- HEDT: 4 vagy 8 CCD + 1 IOD lapka
- 1S/2S szerverek: 4 vagy 8 CCD + 1 IOD lapka

7.7.3. Harmadik generáció

Építő blokkok:

- 8 magos, GPU-t nem tartalmazó CCD lapka (egy CCX + uncore)
- 8 magos APU lapka (CCX + Vega GPU + uncore)
- cIOD és IOD

Ebből épülő processzorok:

- Mobil és Desktop APU-k: 1 APU lapka
- GPU nélküli desktop: 1 vagy 2 CCD lapka + 1 kliens IO lapka
- 1S/2S szerverek: 4 vagy 8 CCD + 1 IOD lapka

7.8. Infinity Fabric

Az Infinity Fabric az AMD Zen architektúrához tervezett cache koherens kapcsolati rendszer. Feladatai:

- lapkák összekötése cache koherens módon
- bizonyos vezérlési funkciók biztonsítása

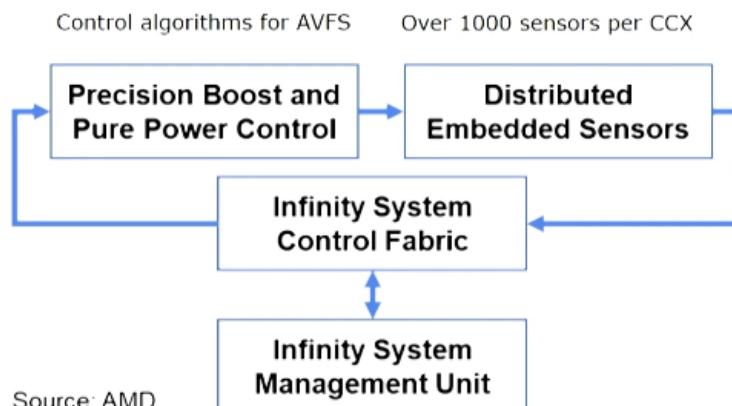
Alapja a korábban használt HyperTransport buszrendszer (hasonló, mint az Intel QPI - Quick Path Interconnect). A feladatok ellátásához két alapvető részből áll az Infinity Fabric: Scalable Control Fabric és Scalable Data Fabric.

7.8.1. Scalable Control Fabric

Felelősségi körei:

- disszipáció kezelése
- biztonság
- minőségi kérdések

Tartalmaz központi és távoli elemeket. A távoli elemek jellemzően szenzorok mint pl. hőmérséklet, frekvencia vagy feszültség szenzorok. Ezeket az AMD egy zárt hurokban használja, egy központi vezérlés mellett (7.10).



7.10. ábra. A Control Fabric működése

A szenzorok száma nagyon nagy (>1000).

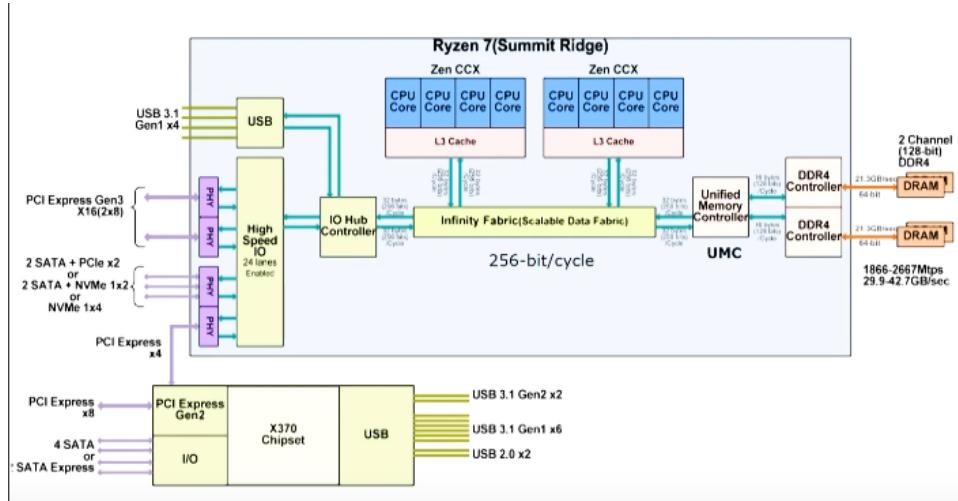
7.8.2. Scalable Data Fabric

A HyperTransport busz továbbfejlesztett változata. Feladatai:

- lapkán belül a különböző egységek összekapcsolása (CCX, memória és IO vezérlők)
- lapkák összekapcsolása (IFOP On-Package linkek)
- 2S szervereknél a tokok összekötése (IFIS: IF Inter-Socket linkek)

7.8.3. Példa: első generációs, GPU nélküli desktop Zen CPU

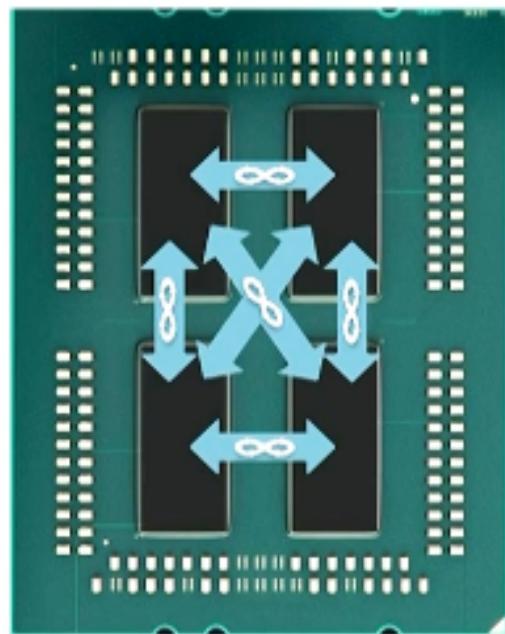
A Ryzen 1000 két CCX blokkot és egy IO vezérlőt tartalmaz, amiket az Infinity Fabric köt össze, 256 bit széles adatátvitelt garantálva (7.11).



7.11. ábra. A Ryzen 1000 IF felépítése

7.8.4. Példa: első generációs EPYC szerver CPU

Az EPYC szerverprocesszorok egy tokozásban több lapkát tartalmaznak, amiket az Infinity Fabric (IFOP) köt össze (minden lapkát minden lapkával).



The 4 dies are
8-core Zeppelin dies

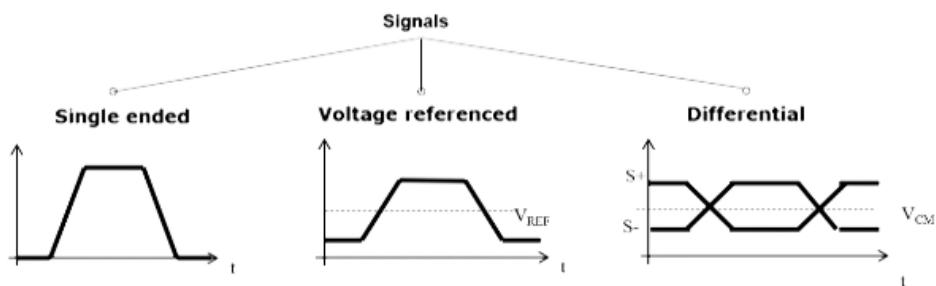
7.12. ábra. Négy Zeppelin lapka összekötése IFOP linkkel

Ezek a linkek kétirányú 32 bites kapcsolatot valósítanak meg, föld-referenciált (single-ended) jelekkel, differenciált órajellel. Az energiaigénye átvitelenként 2 pJ, egy memóriafrekvencia során pedig 4 átvitel történik.

Jelfajták

A buszok esetében három jelrendszer különböztetünk meg (7.13):

- Föld referenciált - single ended: TTL, LVTTL és SDRAM használja
- Feszültség referenciált: FSB, DDR használja
- Differenciál erősítő minden két bemenetén jel van: QPI, PCIe, egyéb soros buszok

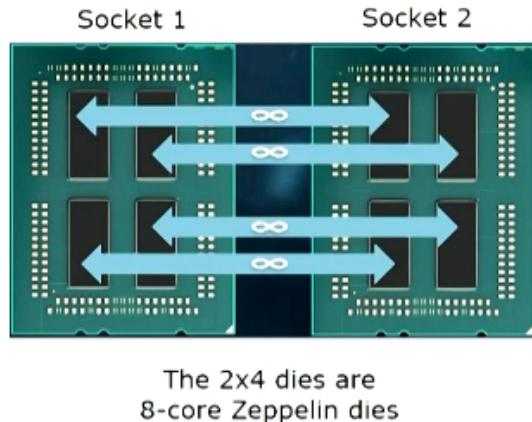


7.13. ábra. Buszok jelrendszeri

Az ábrán balról jobbra egyre kisebb löketű és egyre jobb biztonságú jelek láthatók, ezért az új rendszerek szinte kizárolagosan a differenciált jelet használják. Ennek viszont a hátránya a nagyobb teljesítmény igény.

7.8.5. Példa: első generációs 2S EPYC szerver CPU

2S szervereknél az IFIS (Infinity Fabric Inter-Socket) köti össze a tokokat, minden lapkát lapkát minden lapkával.



7.14. ábra. IFIS link felépítése 2S EPYC processzoroknál

Az IFIS kapcsolatonként 16 vezetékpáróból épül fel, amiknek hosszabb távot kell megtennie (>20 mm). A nagyobb távolság miatt több zavar probléma léphet fel, ezért itt már áttértek a megbízhatóbb, differenciált átvitelre. Ennek a következménye a nagyobb teljesítmény igény: 11 pJ/bit.

7.8.6. Második generációs IF

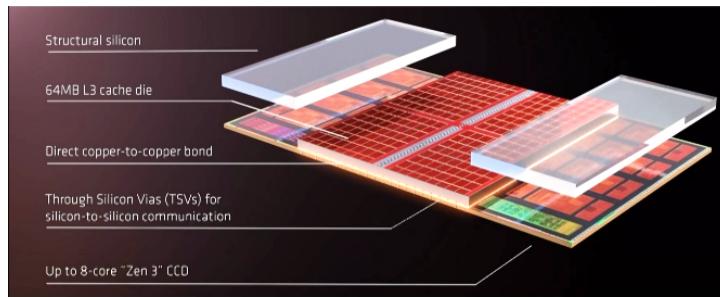
Az Infinity Fabric második generációjában növelték az átviteli szélességet 512 bitre, a működést függetlenítették az órafrekvenciától és 27%-kal csökkentették a teljesítmény igényt.

7.9. MCM tokozás

Egy tokozás háromféle lehet:

- 2 dimenziós (horizontális lapka elhelyezés): a lapkák egymás mellé kerülnek, közöttük elektromos kapcsolat áll fent (pl. Intel EMIB, AMD MCM)
- 3 dimenziós (vertikális tokozás): a lapkák egymás fölé kerülnek és itt is megvan az összeköttetés. Előnye a nagyobb sűrűség, hátránya a rosszabb hűtés. (pl. Intel Foveros)
- 2D és 3D kombinációja: Foveros+EMIB

Az MCM (Multi-Chip Module) egy két dimenziós tokozási eljárás. 2021 augusztusában az AMD bejelentette, hogy ők is készítenek 3D tokozási eljárást. A megoldásnak köszönhetően 192 MB-ra tudják emelni az L3 cache-t (7.15).



7.15. ábra. Az AMD által bejelentett 3D tokozás

7.10. A Zen processzorcsalád tagjai

A Zen családon belül különböző márkanevekkel látják el az eltérő kategóriák processzorait:

- mobil és kliens processzorok: Ryzen
- HEDT: Ryzen és Threadripper
- szerverek: EPYC

A Ryzenen belül sorozatok különböznek el: 3, 5, 7 és 9. Ezek a teljesítményre vonatkoznak és a sorozat határozza meg a magszámot is. A belépő szinten 4-6 mag, magasabb teljesítményű desktopoknál 16, HEDT-eknél pedig 64 mag jellemző.

A processzorok elkülöníthetők GPU-t tartalmazó (mobil, desktop) és nem tartalmazó (desktop, HEDT, szerver) CPU-kra. A GPU-t nem tartalmazó CPU-k több lapkából állnak (kivéve 1. generációs GPU nélküli Ryzenek), a GPU-val szereltek viszont egylapkás SoC-ok.

Tokozás szempontjából eltérnek a desktopok és a mobilok. Míg a desktopokat PGA (Pin Grid Array) tokozással látják el, a mobilok BGA (Ball Grid Array) forrasztott tokozást használnak. A szerverek és desktopok tokozása fizikailag azonos, de nem kompatibilisek egymással.

A Pro jelzéssel ellátott processzorok biztonsági, megbízhatósági és egyéb, főleg vállalati felhasználásban hasznos funkciót tartalmaznak.

7.11. Példa: Zen 3 alapú, GPU nélküli Ryzen 5000

A processzor a Vermeer architektúrára épül, 2020 végén jött ki. Játékos célokat használ, a frekvencia szorzója nem rögzített. Két változata van:

- 8 magot és két lapkát tartalmazó tartalmazó kisebb verzió (CCD + cIOD)
- három lapkát tartalmazó nagyobb verzió (2xCCD + cIOD)

Mind AM4 tokozással rendelkeznek és 400 vagy 500-as chipkészlettel működnek. A Ryzen 9 5950X vette át elsőnek az Inteltől a teljesítmény koronát, eközben viszonylag olcsók és fogyasztásban is jobbak az Intelknél.

Benchmarkok alapján az egyszálas, többszálas és valós felhasználási esetekben is kb. 20 év után az AMD a Zen 3 processzorokkal átvette a vezetést az Inteltől.

Jelenleg a Zen 3 alapú AMD processzorok a szerverekben is átvették a vezetést az Inteltől.